MC121、40V、単相 BLDC ドライバ

1 特長

- ホールセンサ内蔵、N チャネル H ブリッジ ドライバ
- $R_{DS(ON)}$: 850mΩ (HS+LS)
- 電流定格
  - 設定可能な電流制限最大 1.21A
  - 0.6A rms (T_A = 85°C、$R_{\theta JA}$ = 100°C/W)
- 内蔵電源 (VM) クランプ
- 速度曲線と開始デューティ サイクルを設定可能
- 整流方式:方形波またはソフト (最大 90°)
  - 方形波:最大トルク / 速度
  - ソフト:速度と音響の最適化
- 設定可能な速度リファレンス入力:PWM または DC
  - 入力 PWM 周波数範囲:20Hz ～ 90kHz
  - 入力 DC 電圧範囲:(0 ～ 3) V
- 設定可能な出力 PWM 周波数:25kHz または 50kHz
- 閉ループ速度制御精度:±3%
- PWM ディザリングにより EMI を低減
- 設定可能なソフト スタート時間
- ホール オフセット角度および時間を設定可能
- 速度出力 0.5 倍、1 倍、2/3 倍、2 倍
- 回転子ロック検出および故障出力 (RD)
- 設定可能な PWM モード
  - ハイブリッド、同期、非同期
- 高速全域での高効率を実現する自動消磁
- I^2C を介したワンタイム プログラミング (2 ページ)
- 保護機能
  - 出力過電流保護、自動再起動付き
  - 自動再起動付き回転子ロック保護 (LRP)
  - VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  - VM 過電圧保護 (OVP)
  - サーマル シャットダウン (TSD)
  - 構成可能な故障時のリトライ時間
- 機能的特徴 (動作継続)
  - FG/RD が GND を短絡した場合
  - PWM/DC が VM に短絡した場合

2 アプリケーション

- 産業用機器冷却ファン
- 換気用および排気用ファン
- 家電製品用冷却ファン
- 医療用機器用ファン
- 電源装置冷却ファン
- ブロワ

3 説明

MC121 は、40V、850mΩ 定格のモーター ドライバで、単相ブラシレス DC モーター向けに、N チャネル フルブリッジ MOSFET、チャージ ポンプ、ホール センサ、整流制御ロジック、保護回路を内蔵しています。ホール センサは、回転子の位置情報を整流ロジックに提供し、連続的な回転子の動作を維持します。整流ロジックは、方形波とソフト PWM 波形に設定して、音響ノイズを低減したり、速度 / 効率を最大化したりできます。

PWM/DC ピンのパルス幅変調信号のデューティ サイクル、または (0 ～ 3)V の DC 電圧により、モーター速度が制御されます。FG/RD ピンは、モーター速度、回転子ロック状態、故障を外部コントローラに通知するように設定できます。PWM/DC ピンと FG/RD ピンは、製造時に OTP を構成するためのプログラミング (OTP) モードをサポートする I^2C インターフェイスとして設定することもできます。

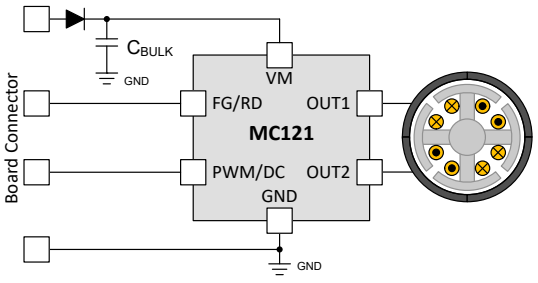
MC121 は、モーターとデバイスの保護機能を内蔵しています。主な保護機能として、電源低電圧誤動作防止、過電圧保護、出力過電流保護、デバイス過熱シャットダウン、回転子ロック保護などがあります。

MC121 は、2 種類の 6 ピン パッケージ:SOT23-THN and X2SON。SOT23-THN は、最大高さ 1.1mm のフラット リード パッケージです。X2SON は、最大高さ 0.4 mm のリードなしパッケージです。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)
MC121DEZR	X2SON (6)	2.50mm × 2.00mm
MC121DYMR(3)	SOT23-THN (6)	3.80mm × 2.90mm

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
(2) パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
(3) このデバイスの情報は事前情報です。



概略回路図

このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

目次

1 特長.....1
2 アプリケーション.....1
3 説明.....1
4 ピン構成および機能.....3
5 仕様.....4
5.1 絶対最大定格.....4
5.2 ESD 定格 ().....4
5.3 推奨動作条件.....4
5.4 熱に関する情報.....4
5.5 電気的特性.....5
5.6 I2C のタイミング要件.....9
5.7 タイミング図.....10
6 詳細説明.....11
6.1 概要.....11
6.2 機能ブロック図.....11
6.3 機能説明.....11
6.4 デバイスの機能モード.....30
6.5 プログラミング.....31
7 レジスタ マップ.....33
7.1 USR_OTP レジスタ.....34
7.2 USR_TM レジスタ.....64
8 アプリケーションと実装.....72
8.1 アプリケーション情報.....72
8.2 代表的なアプリケーション.....74
8.3 電源に関する推奨事項.....76
8.4 レイアウト.....77
8.5 ホール素子の位置.....80
9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....82
9.1 デバイス サポート.....82
9.2 ドキュメントのサポート.....82
9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....82
9.4 サポート・リソース.....82
9.5 商標.....82
9.6 静電気放電に関する注意事項.....82
9.7 用語集.....82
10 改訂履歴.....82
11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....82

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

4 ピン構成および機能

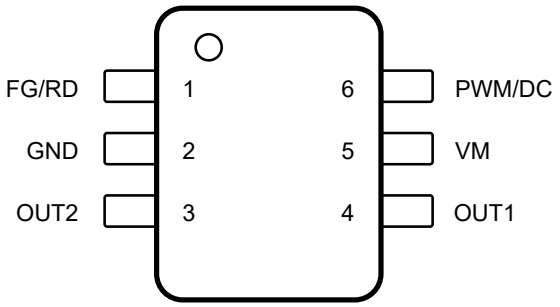


図 4-1. MC121、6 ピン SOT23-THN、上面図

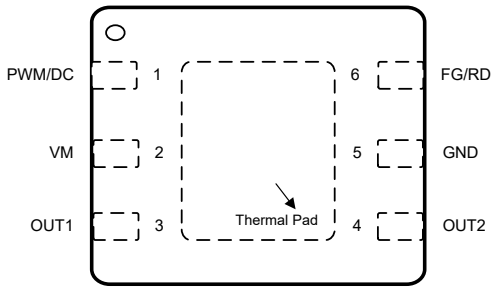


図 4-2. MC121、6 ピン X2SON、上面図

表 4-1. ピンの機能

ピン	パッケージ		タイプ(1)	説明
名称	SOT23-THN	X2SON		
FG/RD	1	6	O	モーター速度、回転子ロック、故障インジケータ出力。オープンドレイン出力には、所定のロジック High 電圧への外部プルアップ抵抗が必要です。テスト / プログラミング モードでは、このピンは I^2C インターフェイスの SDA ピンになります。
GND	2	5	G	デバイスのグランド。システム グランドに接続。
OUT1	4	3	O	ハーフブリッジ出力。モーターの巻線に接続します。
OUT2	3	4	O	ハーフブリッジ出力。モーターの巻線に接続します。
VM	5	2	P	デバイスおよびモーターの電源。モーター電源電圧に接続し、1 つの 0.1µF コンデンサおよび 1 つのバルク コンデンサを使用して GND にバイパスします。コンデンサの電圧定格は、デバイスの通常動作電圧の 2 倍以上とすることを推奨します。
PWM/DC	6	1	I	モーター速度制御ピン - PWM または DC 信号を使用できます。PWM 入力モード (PWMDC_MODE = 0x0) でフローティングのままにすると、このピンは内部で 100% デューティ サイクル入力にプルアップされます。テスト / プログラミング モードでは、このピンは I^2C インターフェイスの SCL ピンになります。
サーマル パッド	該当なし		G	グランドに接続する必要があります。

(1) I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グランド、P = 電源、NC = 未接続

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5 仕様

5.1 絶対最大定格

動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)

		最小値	最大値	単位
電源ピン電圧	VM	-0.5	V_{CLAMP}	V
電源過渡電圧ランプ	VM		2	V/µs
ロジック ピン電圧	PWM/DC	-0.5	V_{VM} + 0.5	V
オープン ドレイン ピン電圧	FG/RD	-0.5	V_{VM} + 0.5	V
出力ピン電圧	OUTx	-1	V_{VM} + 1	V
ピーク出力電流 (OUTx)	OUTx		1.44	A
オープン ドレイン出力電流	FG/RD		25	mA
周囲温度、T_A		-40	125	°C
接合部温度、T_J		-40	150	°C
保管温度、T_{stg}		-65	150	°C

(1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。

5.2 ESD 定格 ()

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠(1)	±6000	V
		荷電デバイス モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠(2)	±1000	

(1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
(2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

5.3 推奨動作条件

動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

			最小値	公称値	最大値	単位
V_{VM}	電源電圧	VM	3.2		35	V
V_{IN}	ロジック入力電圧	PWM/DC (PWM モードで構成されている場合)	0		V_{VM}	V
V_{IN}	アナログ入力電圧	PWM/DC (DC モードで構成されている場合)	0		3.2	V
f_{PWM_IN}	PWM 周波数	PWM	0.02		90	kHz
V_{OD}	オープン ドレイン プルアップ電圧	FG/RD	0		V_{VM}	V
I_{OD}	オープン ドレイン出力電流	FG/RD			20	mA
T_A	動作時周囲温度		-40		125	°C
T_J	動作時接合部温度		-40		150	°C

5.4 熱に関する情報

熱評価基準(1)		MC121 SOT-23-FL (DYM) 6 ピン	MC121 X2SON (DEZ) 6 ピン	単位
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	156.1	74.3	°C/W

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

熱評価基準(1)		MC121 SOT-23-FL (DYM) 6 ピン	MC121 X2SON (DEZ) 6 ピン	単位
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	63.1	39.6	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	25.6	45.3	°C/W
Ψ_{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	10.1	0.4	°C/W
Ψ_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	25.5	45.3	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	16.3	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション レポートを参照してください。

5.5 電気的特性

MC121: 3.2V ≤ V_{VM} ≤ 35V、–40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)
標準値は T_J = 25°C、V_{VM} = 12V の条件下でのものです。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
電源 (VM)						
I_{VMQ}	VM スリープ モード電流	$V_{PWM/DC}$ = 0V、SLEEP_EN = 0x1		0.08	0.14	mA
I_{VM}	VM アクティブ モード電流	$V_{PWM/DC}$ = 3V (PWMDC_MODE = 0x1) またはフローティング (PWM_DC = 0x0)、OUTx 間は無負荷		3.9	5	mA
t_{WAKE}	スタンバイ / スリープ モードからのターンオン時間	PWM 入力デューティを 0% から 100% まで変化させてから、OUTx がスイッチングするまでの時間 (PWMDC_MODE = 0x0、PWM_IN_RANGE = 0x0)			16	ms
		PWM 入力デューティを 0% から 100% まで変化させてから、OUTx がスイッチングするまでの時間 (PWMDC_MODE = 0x0、PWM_IN_RANGE = 0x1)			64	ms
	スタンバイ / スリープ モードからのターンオン時間	DC 入力を 0V から 3V まで変化させてから、OUTx がスイッチングするまでの時間 (PWMDC_MODE = 0x1)			1	ms
t_{STOP_DET}	DIN = 0% の検出に要する時間	PWM 入力デューティが 100% から 0% に変化してから、RAMP_ON_STOP_DIS に従ってモーター停止を開始するまでの時間 (PWMDC_MODE = 0x0、PWM_IN_RANGE = 0x0)			16	ms
		PWM 入力デューティが 100% から 0% に変化してから、RAMP_ON_STOP_DIS に従ってモーター停止を開始するまでの時間 (PWMDC_MODE = 0x0、PWM_IN_RANGE = 0x1)			64	ms
	DIN = 0% の検出に要する時間	DC 入力が 3V から 0V に変化してから、RAMP_ON_STOP_DIS に従ってモーター停止を開始するまでの時間 (PWMDC_MODE = 0x1)			1.5	ms
PWM/DC (SCL) および FG/RD (SDA)						
V_{IL}	入力ロジック Low 電圧	アクティブまたはスタンバイ状態、あるいは SCL モード時、PWM/DC ピンは PWM 入力モード (PWMDC_MODE = 0x0)、FG/RD ピンは SDA モード			0.8	V
V_{IH}	入力ロジック High 電圧		2			V
V_{HYS}	入力ヒステリシス		0.15	0.2	0.28	V
V_{SLEEP_DC}	DC 入力モードでのスリープ移行のための PWM/DC ピンの電圧スレッショルド	PWM/DC ピンに印加される電圧、SLEEP_EN = 0x1、PWMDC_MODE = 0x1	0.04		0.12	V

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

MC121: 3.2V ≤ V_{VM} ≤ 35V、–40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)
標準値は T_J = 25°C、V_{VM} = 12V の条件下でのものです。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
I_{IL} (PWM/DC)	入力ロジック Low 電流	V_I = 0V、SLEEP_EN = 0x0、PWM/DC ピンは PWM 入力モード (PWMDC_MODE = 0x0) または SCL モード	215	245	270	µA
		V_I = 0V、SLEEP_EN = 0x0、PWM/DC ピンは DC 入力モード (PWMDC_MODE = 0x1)			1	µA
		V_I = 0V、SLEEP_EN = 0x1、PWM/DC ピンは PWM 入力モード (PWMDC_MODE = 0x0) または DC 入力モード (PWMDC_MODE = 0x1) または SCL モード	20	50	70	µA
I_{IH} (PWM/DC)	入力ロジック High 電流	V_I = 3.3V、PWM/DC ピンは PWM 入力モード (PWMDC_MODE = 0x0) または DC 入力モード (PWMDC_MODE = 0x1) または SCL モード	-1		1	µA
		V_I = V_{VM}、PWM/DC ピンは PWM 入力モード (PWMDC_MODE = 0x0) または DC 入力モード (PWMDC_MODE = 0x1) または SCL モード	-1		1	µA
V_{PU} (PWM/DC)	内部プルアップ電圧	PWM 入力モード (PWMDC_MODE = 0x0)、V_{VM} ≥ 3.6V	2.7	2.9	3.2	V
		PWM 入力モード (PWMDC_MODE = 0x0)、V_{VM} < 3.6V	2.55		V_{VM}	V
f_{PWM_IN}	デューティ / 速度リファレンスの入力 PWM 周波数範囲	PWM 入力 (PWMDC_MODE = 0x0)、PWM_IN_RANGE = 0x0	0.08		90	kHz
		PWM 入力 (PWMDC_MODE = 0x0)、PWM_IN_RANGE = 0x1	0.02		22	kHz
V_{PWM_ACC}	PWM 入力からのデューティ / 速度リファレンス精度	20Hz ≦ f_{PWM_IN} ≦ 45kHz		0.4		%
		45kHz < f_{PWM_IN} ≦ 90kHz		0.8		%
V_{DC}	デューティ / 速度リファレンスの DC 入力範囲	DC 入力 (PWMDC_MODE = 0x1)、3.2V ≤ V_{VM} < 4.5V	0		V_{VM} – 1.4	V
		DC 入力 (PWMDC_MODE = 0x1)、4.5V ≤ V_{VM} ≤ 35V	0		3.2	V
$V_{DC_0\%}$	0% デューティ / 速度リファレンス (DIN = 0%) の DC 入力スレッショルド	DC 入力 (PWMDC_MODE = 0x1)	0.04		0.12	V
$V_{DC_100\%}$	100% デューティ / 速度リファレンス (DIN = 100%) の DC 入力スレッショルド	DC 入力 (PWMDC_MODE = 0x1)、3.2V ≤ V_{VM} < 4.5V	V_{VM} – 1.4		3.2	V
		DC 入力 (PWMDC_MODE = 0x1)、4.5V ≤ V_{VM} ≤ 35V	2.8	3	3.2	V
V_{DC_ACC}	DC 入力からのデューティ / 速度リファレンス精度	DC 入力 (PWMDC_MODE = 0x1)、4.5V ≤ V_{VM} ≤ 35V			3	%
V_{OL} (FG/RD)	出力ロジック Low 電圧	I_{OD} = 20mA			0.4	V
I_{OZ} (FG/RD)	出力ロジック High 電流	V_{OD} = 3.3 V	-1		1	µA
I_{OZ} (FG/RD)	出力ロジック High 電流	V_{OD} = V_{VM}	-1		1	µA
ドライバ出力 (OUTx)						
$R_{DS(on)}$ (H+L)	ハイサイドおよびローサイド MOSFET のオン抵抗	V_{VM} = 3.2V、I_O = 500mA、T_A = 25°C		0.9	1.02	Ω
$R_{DS(on)}$ (H+L)	ハイサイドおよびローサイド MOSFET のオン抵抗	V_{VM} = 12V、I_O = 500mA、T_A = 25°C		0.85	0.95	Ω

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

MC121: 3.2V ≤ V_{VM} ≤ 35V、–40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)
標準値は T_J = 25°C、V_{VM} = 12V の条件下でのものです。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
$R_{DS(on)}$ (H+L)	ハイサイドおよびローサイド MOSFET のオン抵抗	V_{VM} = 12V、I_O = 500mA、T_A = 150°C		1.3	1.5	Ω
f_{PWM_OUT}	PWM 出力周波数	PWM_OUT_FREQ = 0x0、DITHER_EN = 0x0	23.5	25	26.25	kHz
f_{PWM_OUT}	PWM 出力周波数	PWM_OUT_FREQ = 0x1、DITHER_EN = 0x0	45	50	55	kHz
デジタルラッチ ホール エフェクト センサ						
B_{OP}	動作ポイント		0.4	0.8	1.6	mT
B_{RP}	リリース ポイント		-1.6	-0.7	-0.4	mT
B_{HYS}	ヒステリシス、B_{HYS} = (B_{OP} - B_{RP})		1.0	1.6	3.2	mT
B_{OF}	磁気オフセット、B_{OF} = (B_{OP} + B_{RP}) / 2		-1	0	1	mT
発振器						
f_{osc}	内部発振器の周波数	V_{VM} = 12V、T_J = 25ºC	24.625	25	25.375	MHz
f_{osc}	内部発振器の周波数		24.19	25	25.75	MHz
デューティ曲線						
D_{OUT_RES}	LSB あたりの出力デューティ サイクル分解能	50% 電圧レベル、0.4% ≦ DOUT ≦ 99.6% で測定		0.4		%
D_{HYS}	D_{IN} 立ち上がりの速度曲線ヒステリシス	DIN_HYS = 0x0。DIN を 0% から DIN0 + DIN_HYS までスイープします。出力 DOUT は DOUT0 からターゲット デューティ サイクルに変化します。		0		%
		DIN_HYS = 0x1。DIN を 0% から DIN0 + DIN_HYS までスイープします。出力 DOUT は DOUT0 からターゲット デューティ サイクルに変化します。		1.2		%
		DIN_HYS = 0x2。DIN を 0% から DIN0 + DIN_HYS までスイープします。出力 DOUT は DOUT0 からターゲット デューティ サイクルに変化します。		2.4		%
		DIN_HYS = 0x3。DIN を 0% から DIN0 + DIN_HYS までスイープします。出力 DOUT は DOUT0 からターゲット デューティ サイクルに変化します。		4.8		%
$SPEED_{ERR}$	閉ループ速度精度	T_J = 25ºC、SPEED_LOOP_EN = 0x1、12.5% x MAX_SPEED ≦ SPEED_REF ≦ MAX_SPEED	-1		2	%
		SPEED_LOOP_EN = 0x1、12.5% x MAX_SPEED ≦ SPEED_REF ≦ MAX_SPEED	-3.5		3.5	%
整流						
$\theta_{HALL_OS_ANGLE}$	最小ホール オフセット角度	HALL_OS_ANGLE = 0x00		0		度
	最大ホール オフセット角度	HALL_OS_ANGLE = 0x1F		43.8		度
$\theta_{HALL_OS_ANGLE_LSB}$	LSB あたりのホール オフセット角度分解能	HALL_OS_ANGLE LSB		1.4		度
T_{HALL_OS}	最小ホール オフセット信号のリード / ラグ時間	HALL_OS_TIME = 0x00		0		µs
	最大ホール オフセット信号リード / ラグ時間	HALL_OS_TIME = 0xFF		2.6		ms
$T_{HALL_OS_LSB}$	LSB ごとのホール オフセット信号リード / ラグ時間分解能	HALL_OS_TIME LSB		10.24		µs

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

MC121: 3.2V ≤ V_{VM} ≤ 35V、–40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)
標準値は T_J = 25°C、V_{VM} = 12V の条件下でのものです。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
t_{DEMAG}	消磁期間の最小時間	DEMAG_TIME = 0x00		0		µs
	消磁期間の最大時間	DEMAG_TIME = 0x7F		5.2		ms
t_{DEMAG_LSB}	LSB ごとの DEMAG_TIME 時間分解能	DEMAG_TIME LSB		40.96		µs
θ_{SRISE}	ソフト立ち上がりの最小角度	SRISE = 0x00		2.8		度
	ソフト立ち上がりの最大角度	SRISE = 0x10		90		度
θ_{SRISE_LSB}	LSB あたりの SRISE の角度分解能	SRISE LSB		2.8		度
θ_{SFALL}	ソフト立ち下がりの最小角度	SFALL = 0x00		2.8		度
	ソフト立ち下がりの最大角度	SFALL = 0x1F		90		度
θ_{SFALL_LSB}	LSB あたりの SFALL の角度分解能	SRISE LSB		2.8		度
プレスタートと PWM ランプ / ソフト スタート						
PWM_RAMP_RATE	ソフト スタートおよび速度変化に対する出力デューティ サイクル ランプ レート	PWM_RAMP_SEL = 0x0 (0 ～ 100% の場合 10.7s)		9.35		%/s
		PWM_RAMP_SEL = 0x1 (0 ～ 100% の場合 5.35s)		18.7		%/s
		PWM_RAMP_SEL = 0x2 (0 ～ 100% の場合 2.67s)		37.4		%/s
		PWM_RAMP_SEL = 0x3 (0 ～ 100% の場合 1.34s)		74.8		%/s
保護回路						
V_{CLAMP}	VM クランプ電圧	I_{clamp} = 20mA	37		43	V
V_{POR}	デバイスの電源投入に必要な VM パワーオン リセットのスレッショルド	電源立ち上がり	2.3	2.55	2.7	V
V_{POR_HYS}	VM パワーオン リセット スレッショルド ヒステリシス	立ち上がりから立ち下がりへのスレッショルド	0.04	0.09	0.13	V
V_{UVLO}	モーターの駆動を開始 / 停止するための電源低電圧誤動作防止スレッショルド	電源立ち上がり (UVLO_SEL = 0x0)	2.85	3	3.15	V
		電源立ち下がり (UVLO_SEL = 0x0)	2.55	2.7	2.85	V
V_{UVLO_HYS}	電源 UVLO ヒステリシス	立ち上がりから立ち下がりまでのスレッショルド (UVLO_SEL = 0x0)		0.33		V
V_{UVLO}	モーターの駆動を開始 / 停止するための電源低電圧誤動作防止スレッショルド	電源立ち上がり (UVLO_SEL = 0x1)	3.97	4.2	4.5	V
		電源立ち下がり (UVLO_SEL = 0x1)	2.55	2.7	2.85	V
V_{UVLO_HYS}	電源 UVLO ヒステリシス	立ち上がりから立ち下がりまでのスレッショルド (UVLO_SEL = 0x1)		1.5		V
V_{UVLO}	モーターの駆動を開始 / 停止するための電源低電圧誤動作防止スレッショルド	電源立ち上がり (UVLO_SEL = 0x2)	5.42	5.7	6	V
		電源立ち下がり (UVLO_SEL = 0x2)	2.55	2.7	2.85	V
V_{UVLO_HYS}	電源 UVLO ヒステリシス	立ち上がりから立ち下がりまでのスレッショルド (UVLO_SEL = 0x2)		3		V
V_{UVLO}	モーターの駆動を開始 / 停止するための電源低電圧誤動作防止スレッショルド	電源立ち上がり (UVLO_SEL = 0x3)	7.2	7.6	8	V
		電源立ち下がり (UVLO_SEL = 0x3)	2.55	2.7	2.85	V
V_{UVLO_HYS}	電源 UVLO ヒステリシス	立ち上がりから立ち下がりまでのスレッショルド (UVLO_SEL = 0x3)		4.9		V
V_{OVP}	電源過電圧保護スレッショルド (OVP)	電源立ち上がり (OVP_SEL = 0x0)	32.7	34.5	36.3	V
V_{OVP}	電源過電圧保護スレッショルド (OVP)	電源立ち下がり (OVP_SEL = 0x0)	31.4	33.2	34.9	V
V_{OVP}	電源過電圧保護スレッショルド (OVP)	電源立ち上がり (OVP_SEL = 0x1)	21.5	22.6	23.9	V
V_{OVP}	電源過電圧保護スレッショルド (OVP)	電源立ち下がり (OVP_SEL = 0x1)	20.1	21.2	22.3	V
V_{OVP}	電源過電圧保護スレッショルド (OVP)	電源立ち上がり (OVP_SEL = 0x2)	17.5	18.1	19.3	V

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

MC121: 3.2V ≤ V_{VM} ≤ 35V、–40°C ≤ T_J ≤ 150°C (特に記述のない限り)
標準値は T_J = 25°C、V_{VM} = 12V の条件下でのものです。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
V_{OVP}	電源過電圧保護スレッショルド (OVP)	電源立ち下がり (OVP_SEL = 0x2)	15.9	16.9	17.9	V
V_{OVP_HYS}	電源過電圧ヒステリシス			1.5		V
t_{OVP_DEG}	電源過電圧グリッチ除去時間		70	80	90	µs
t_{OVP_BLANK}	電源過電圧ブランキング時間	OVP_BLANK_EN = 0x0、OVP_BLANK_SEL = 0x1		1		ms
		OVP_BLANK_EN = 0x0、OVP_BLANK_SEL = 0x0		4		ms
I_{LIMIT}	Current limit threshold	ILIMIT_SEL = 0x0	0.29	0.32	0.37	A
		ILIMIT_SEL = 0x1	0.38	0.43	0.49	A
		ILIMIT_SEL = 0x2	0.48	0.53	0.61	A
		ILIMIT_SEL = 0x3	0.58	0.63	0.73	A
		ILIMIT_SEL = 0x4	0.67	0.73	0.85	A
		ILIMIT_SEL = 0x5	0.76	0.83	0.97	A
		ILIMIT_SEL = 0x6	0.85	0.94	1.09	A
		ILIMIT_SEL = 0x7	0.93	1.02	1.21	A
		ILIMIT_SEL = 0x8	1.02	1.12	1.33	A
		ILIMIT_SEL = 0x9	1.1	1.21	1.44	A
t_{ILIMIT_DEG}	電流制限のグリッチ除去時間	ILIM_DEGLITCH_SEL = 0x0		0.6		µs
	電流制限のグリッチ除去時間	ILIM_DEGLITCH_SEL = 0x1		1.1		µs
I_{OCP}	過電流保護トリップ ポイント (HS_FET)		1.3 * I_{LIMIT}	1.7 * I_{LIMIT}	2.2 * I_{LIMIT}	A
I_{OCP}	過電流保護トリップ ポイント (LS_FET)		1.45 * I_{LIMIT}	1.7 * I_{LIMIT}	1.85 * I_{LIMIT}	A
t_{OCP_DEG}	過電流保護グリッチ除去時間			0.6		µs
t_{LRD_START}	起動時の回転子ロック検出時間	LRD_TIME_STARTUP = 0x0	0.31	0.32	0.34	s
		LRD_TIME_STARTUP = 0x1	0.42	0.44	0.46	s
		LRD_TIME_STARTUP = 0x2	0.5	0.52	0.55	s
		LRD_TIME_STARTUP = 0x3	1	1.05	1.1	s
N_{RETRY}	回転子ロックと過電流に対するロング リトライ時間の倍比率。ロング リトライ時間 = N_{RETRY} × t_{LRD_START}	LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x0		2		
		LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x1		4		
		LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x2		8		
		LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x3		10		
		LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x4		12		
		LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x5		16		
		LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x6		24		
		LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x7		28		
t_{LRD_RUN}	起動後の回転子ロック検出時間	モーター動作中の回転子ロック	0.29	0.32	0.35	s
T_{TSD}	サーマル シャットダウン温度		155	170	185	°C
T_{HYS}	サーマル シャットダウン ヒステリシス			24		°C

5.6 I2C のタイミング要件

		最小値	公称値	最大値	単位
標準モード					
f_{SCL}	SCL クロック周波数	0		100	kHz

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

		最小値	公称値	最大値	単位
$t_{HD,STA}$	(反復) 開始条件のホールド時間。この時間が経過すると、最初のクロック パルスが生成されます	4			µs
t_{LOW}	SCL クロック Low 期間	4.7			µs
t_{HIGH}	SCL クロックの High の時間	4			µs
$t_{SU,STA}$	反復開始条件のセットアップ時間	4.7			µs
$t_{HD,DAT}$	データ ホールド時間:I2C バス デバイスの場合	0.01		3.45	µs
$t_{SU,DAT}$	データ セットアップ時間	250			ns
t_R	SDA と SCL の立ち上がり時間			1000	ns
t_F	SDA と SCL の立ち下がり時間			300	ns
$t_{SU,STO}$	STOP 条件のセットアップ時間	4			µs
t_{BUF}	STOP 条件と START 条件の間のバス フリー時間	4.7			µs
高速モード					
f_{SCL}	SCL クロック周波数	0		400	kHz
$t_{HD,STA}$	(反復) 開始条件のホールド時間。この時間が経過すると、最初のクロック パルスが生成されます。	0.6			µs
t_{LOW}	SCL クロック Low 期間	1.3			µs
t_{HIGH}	SCL クロックの High の時間	0.6			µs
$t_{SU,STA}$	反復開始条件のセットアップ時間	0.6			µs
$t_{HD,DAT}$	データ ホールド時間:I2C バス デバイスの場合	0.01		0.9	µs
$t_{SU,DAT}$	データ セットアップ時間	50			ns
t_R	SDA と SCL の立ち上がり時間			300	ns
t_F	SDA と SCL の立ち下がり時間			300	ns
$t_{SU,STO}$	STOP 条件のセットアップ時間	0.6			µs
t_{BUF}	STOP 条件と START 条件の間のバス フリー時間	1.3			µs
t_{SP}	入力ノイズ フィルタにより抑制されるスパイクのパルス幅		50		ns

5.7 タイミング図

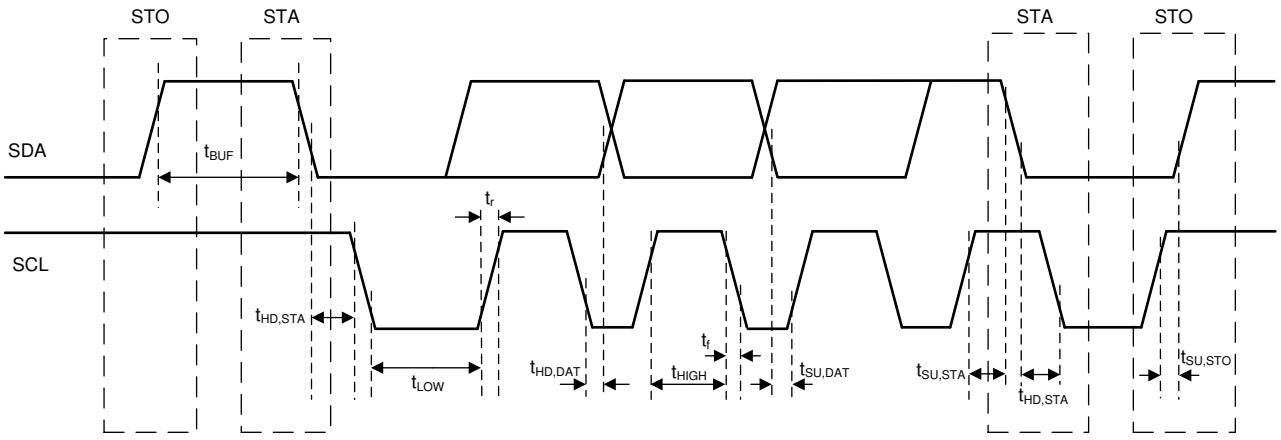


図 5-1. I²C のタイミング図

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

6 詳細説明

6.1 概要

MC121 は、40V、850mΩ 定格、1.21A ピークの単相 BLDC モータードライバで、N チャネル フルブリッジ FET、チャージ ポンプ、ホール センサ、整流制御ロジック、保護回路を内蔵しています。ホール センサは、回転子の位置情報を整流ロジックに提供し、連続的な回転子の動作を維持します。整流ロジックは、方形波とソフト PWM 波形に設定して、音響ノイズを低減したり、速度 / 効率を最大化したりできます。

6.2 機能ブロック図

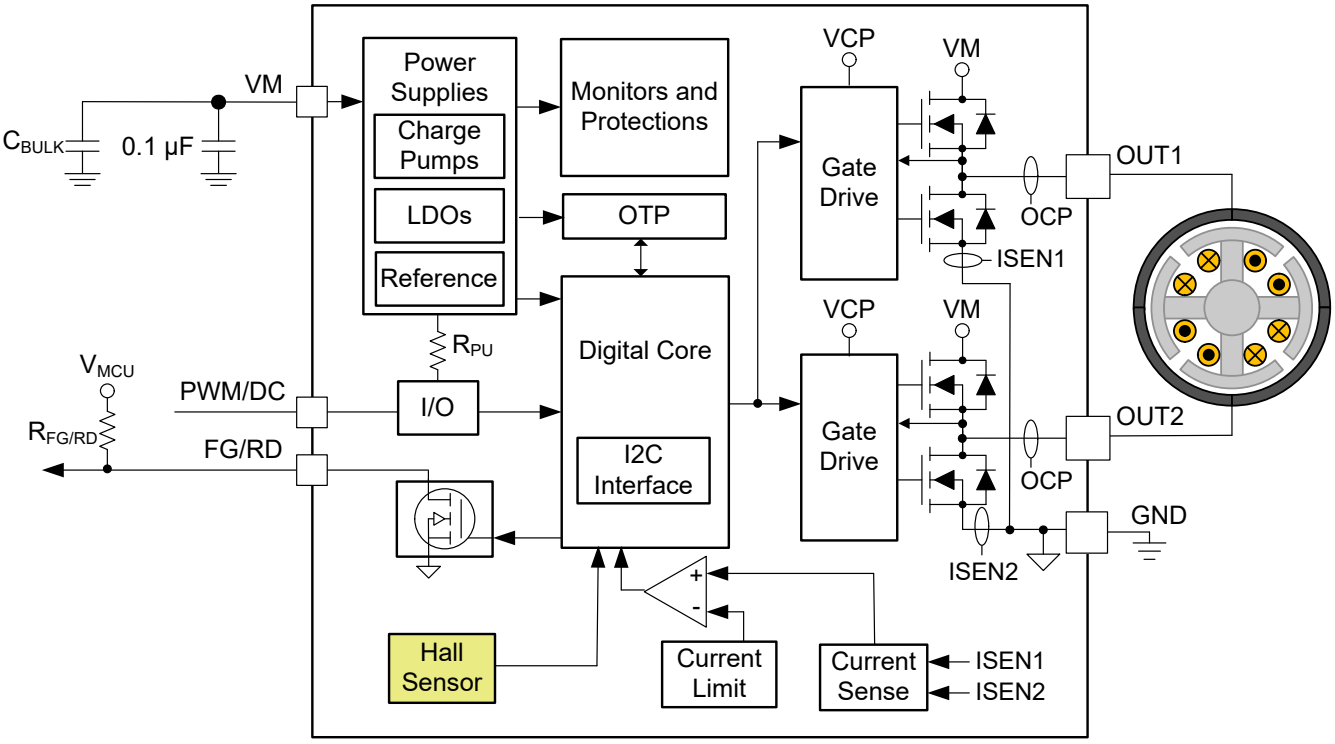


図 6-1. MC121 機能ブロック図

6.3 機能説明

6.3.1 モーター制御

MC121 は、PWM/DC ピンにパルス幅変調 (PWM) または DC (アナログ) 入力を受け取ることで、モーター速度を制御します。MC121 は、入力デューティ (図 6-2 の DIN) をユーザー設定のターゲット出力デューティ サイクル (図 6-2 の DOUT_TARGET) にマッピングするための、設定可能なデューティ曲線を提供します。MC121 は、出力デューティ サイクル (図 6-2 の DOUT) をスムーズに増減させて DOUT_TARGET に到達させるための、ユーザーが設定可能なデューティ ランプも提供します。

MC121 は、開ループ (デューティ サイクル) 制御と閉ループ (速度) 制御の両方をサポートしています。開ループ (デューティ サイクル) 制御では、印加されるデューティ サイクルは DOUT によって直接設定されます。閉ループ (速度) 制御では、印加されるデューティ サイクルは速度ループによって設定されます。

内蔵のデジタルラッチ ホール センサは、整流アルゴリズムに対して回転子の位置とタイミングの情報を提供します。MC121 は、効率、モーター速度、音響ノイズの間で最適化するために、方形波およびソフト PWM 出力波形整形方式をサポートしています。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

MC121 は、H ブリッジでハイブリッド、同期、非同期出力 PWM 変調モードを提供します。設定可能なホール リード / ラグ角度と時間調整により、低速および高速の両方で効率を向上させることができます。さらに、MC121 は、整流前にモーター巻線電流をゼロにまで低減させるために、設定可能な消磁機能 (自動または手動) を備えており、DC バス (VM) 電圧スパイクや音響ノイズを最小化し、効率を向上させることができます。

MC121 は、整流開始時に 0% デューティを適用してピーク電流を低減するように設定可能な、サイレンス角度機能を備えています。サイレンス角度は SILENCE_ANGLE ビットで設定できます。

図 6-2 に、MC121 のモーター制御ブロック図を示します。

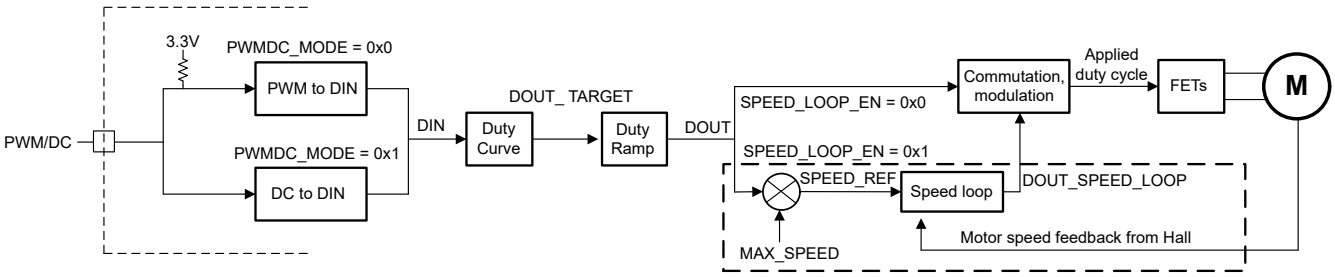


図 6-2. MC121 モーター制御のブロック図

6.3.1.1 デューティ入力

MC121 は、PWM/DC ピンからデューティ入力 (DIN) を受け取ります。PWM/DC 入力は PWM 信号と DC (アナログ) 信号のどちらかにでき、PWMDC_MODE ビットによって選択されます。入力 PWM 周波数の範囲は 20Hz ～ 90kHz (PWM_IN_RANGE ビットで設定された入力 PWM 周波数の範囲) で、DC 入力の範囲は 0 ～ 3V です。

PWM 入力モードの PWM/DC ピンには、デューティ入力 (DIN) を 100% に設定するプルアップ機能が内蔵されています。この機能は、オン / オフ制御のみを必要とするアプリケーション用に、ピンがフローティング / 未接続のままになっている場合に使用します。DC 入力モードでは、外部回路を使用して、PWM/DC ピンを強制的に目的の値に設定する必要があります。

注

PWRUP_PWMDC_MASK が 0x1 に設定されている場合、MC121 はパワーアップ後、1 秒間待機してから、PWM/DC ピンからの入力に反応します。PWRUP_PWMDC_MASK が 0x0 に設定されている場合、パワーアップ時の待機時間はありません。

6.3.1.2 デューティ曲線

MC121 は、図 6-3 に示すように、構成可能なデューティ曲線をサポートしています。この機能により、特定の使用事例に応じて、ターゲット出力デューティ サイクル (DOUT_TARGET) を入力デューティ (DIN) の関数として設定し、単一プラットフォームでさまざまな最終アプリケーションに対応する BLDC ドライバ設計を実現できます。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

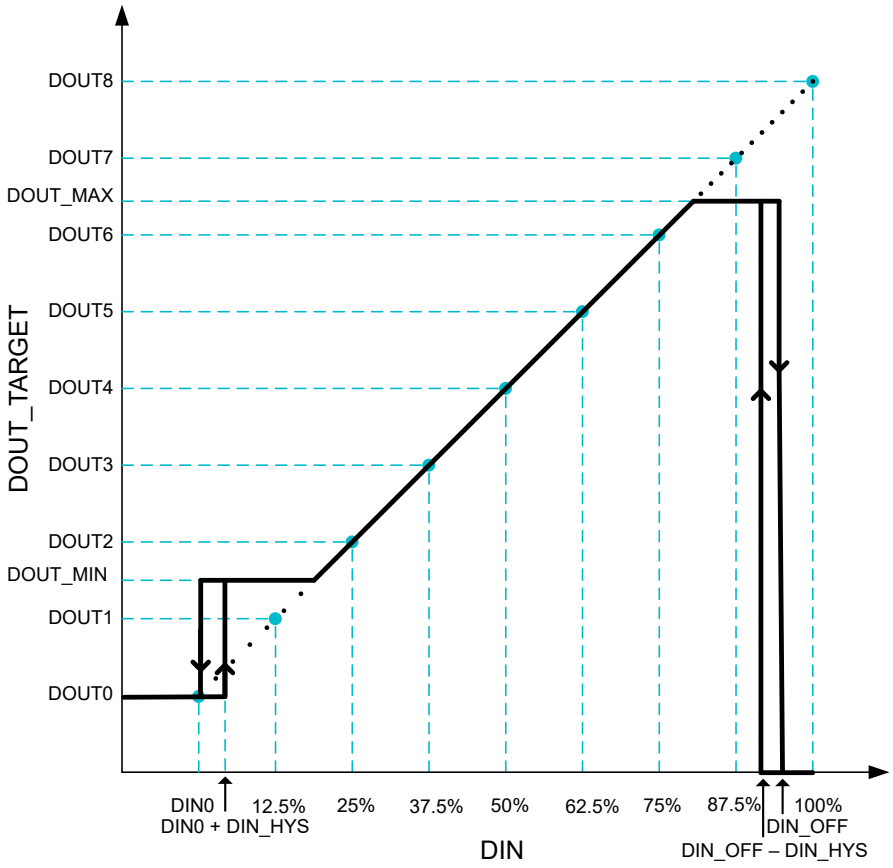


図 6-3. デューティ曲線

デューティ曲線上の構成可能なポイントは次のとおりです。

- **DIN0、DOUT0**：DIN0 は、STBY_EN = 0x1 になるとモーターが駆動を開始するように、最小入力 (開始) デューティ サイクルを設定するために使用できます。モーターは DIN ≥ (DIN0 + DIN_HYS) になるまで駆動されません。DIN_HYS は、DIN0 付近のヒステリシスを設定し、モーターの駆動を開始 / 停止します。MC121 は、STBY_EN を 0x0 に、DOUT0 をゼロでない値に設定することで、DIN < DIN0 の場合でもモーターを駆動する機能も備えています。DIN = 0% のときのデバイスの状態は、表 6-5 に示すように、SLEEP_EN ビットと STBY_EN ビットによって設定されます。
- **DIN_OFF**：DIN_OFF は最大入力デューティ サイクル (DIN) を設定します。これを上回ると、モーターの駆動を停止するためのターゲット出力デューティ サイクル (DOUT_TARGET) が 0 に設定されます。DIN ≥ DIN_OFF の場合、DOUT_TARGET は 0% に設定されます。DIN < (DIN_OFF - DIN_HYS) になると、モーター駆動が再開されます。
- **DOUT_MIN**：DOUT_MIN は、DIN0 < DIN < DINOFF のときの最小ターゲット出力デューティ サイクル (DOUT_TARGET) を設定します。
- **DOUT_MAX**：DOUT_MAX は、DIN < DINOFF のときの最大ターゲット出力デューティ サイクル (DOUT_TARGET) を設定します。閉ループ (速度制御) 動作では、最大ターゲット出力デューティ サイクルは速度ループによって設定されます。
- **DOUTx**：DOUTx は、入力デューティ (DIN) の固定の間隔でターゲット出力デューティ (DOUT_TARGET) を設定します。DOUT1 は DIN = 12.5% のときのターゲット出力デューティを設定し、DOUT2 は DIN = 25% のときのターゲット出力デューティを設定します。以降同様に、DOUT8 は DIN = 100% のときのターゲット出力デューティを設定します。DOUTx を使用すると、図 6-3 に示すように正のスロープ デューティ曲線を設定することも、図 6-4 に示すように負のスロープを設定することもできます。また、DOUTx を使用して、混合スロープ (正、負、ゼロ) を設定することもできます (図 6-5 を参照)。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

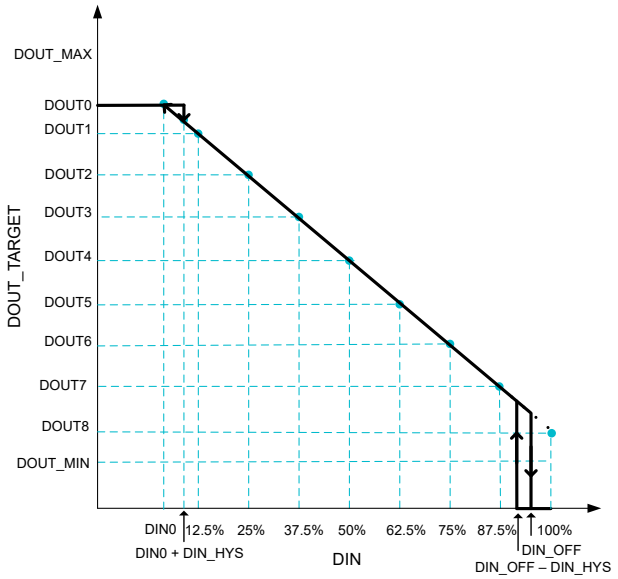


図 6-4. デューティ曲線 - 負のスロープ

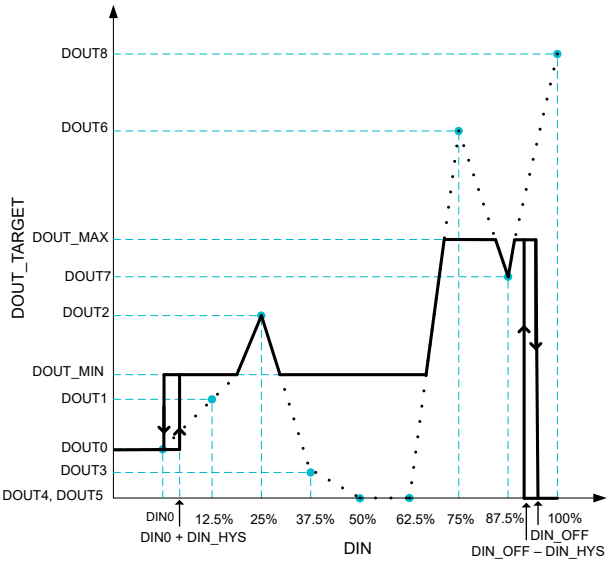


図 6-5. デューティ曲線 - 混合スロープ

アナログ速度入力モード (PWMDC_MODE = 0x1) を使用する場合、PWM/DC ピンは 0V ～ 3V のアナログ電圧を受け入れ、出力デューティ サイクル (開ループ) または速度 (閉ループ) を制御します。DC 入力モードでは、PWM/DC ピンの電圧は 0V ～ 3V から 0% ～ 100% (DIN) に直線的にマップされます。

6.3.1.3 モーターの起動、速度変更、停止

モーター起動

MC121 は、図 6-6 に示すように、モーター起動時にターゲット出力デューティ サイクル (図 6-2 の DOUT_TARGET) に到達するための、ユーザー設定可能なランプ機能を備えています。この 2 段階ランプ (プリスタート、その後にソフト スタート) によって、信頼性の高い起動とモーター ノイズの低減が可能になります。

MC121 は、スタンバイ モード、スリープ モード、または故障モードを抜けると、プリスタート フェーズに移行します。PRESTART_RAMP_EN が 0x1 に設定されている場合、出力デューティ サイクル (図 6-2 の DOUT) は PWM_RAMP_SEL で設定されたレートで開始デューティ サイクル (速度ループが無効の場合 DOUT_START × DOUT_MAX、速度ループが有効の場合 DOUT_START) から直線的に増加します。PRESTART_RAMP_EN が 0x0 に設定されている場合、DOUT は DOUT_TARGET によって直接更新されます。プリスタート フェーズは、16 から 32 のホール エッジが観測されるまで続きます。

PWM_RAMP_EN が 0x1 に設定されている場合、プリスタート フェーズの後、出力デューティ サイクル (DOUT) は、PWM_RAMP_SEL で設定されたレートで DOUT_TARGET まで DOUT を直線的に増加します。プリスタート フェーズの終了時で DOUT がすでに DOUT_TARGET に達している場合、デバイスは直ちに定常状態に入ります。DOUT が出力デューティまたは速度目標値に到達すると、ソフト スタート フェーズは終了します。PWM_RAMP_EN が 0x0 に設定されている場合、プリスタート フェーズの終了後、DOUT は DOUT_TARGET によって直接更新されます。

プリスタート フェーズ中、MC121 は常に方形波整流方式でモーターを駆動します。MC121 は、プリスタート フェーズ中にはホール オフセット (角度および時間オフセット) を適用しません。プリスタート フェーズ中には消磁時間 (DEMAG_TIME 構成で設定) が適用され、起動時の DC バス電圧スパイクを最小限に抑えます。ソフトスタート フェーズでは、ホール オフセットと消磁時間 (AUTO_DEMAG_EN 構成で設定) の両方が適用され、MC121 は COMMUTATION_MODE によって設定された整流方式を使用します。

MC121 が回転子ロック検出時間 t_{LRD} 内にホール信号遷移を検出しなかった場合、デバイスは回転子ロック保護故障状態に移行します。起動シーケンス中の回転子ロック検出時間 (t_{LRD_START}) は、LRD_TIME_STARTUP によって設定さ

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

れます。モーター運転中、回転子ロック検出時間 (t_{LRD_RUN}) は 320ms に固定されます。プリスタート フェーズ中、ホール オフセット (角度および時間) は無効化されます。

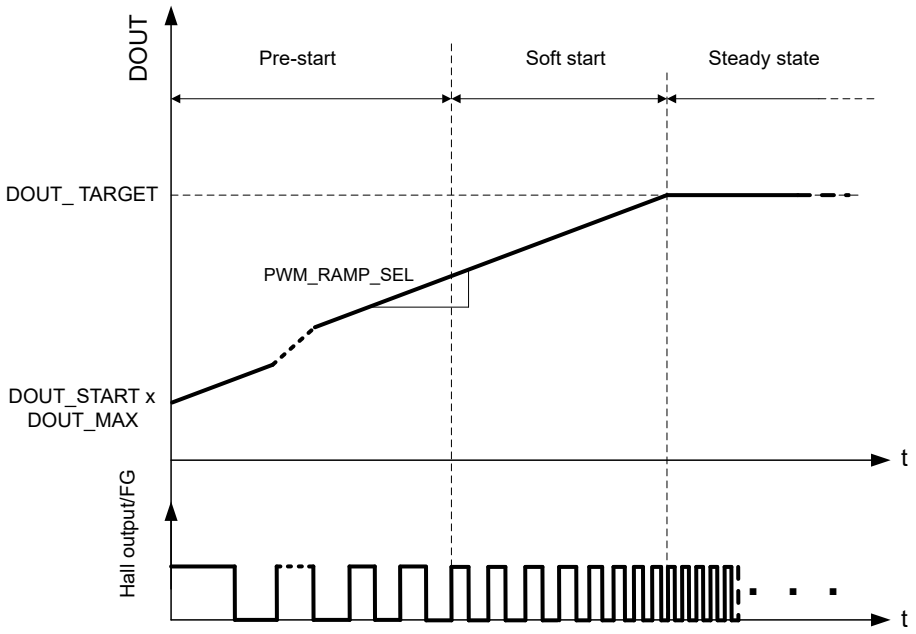


図 6-6. モーター起動時の出力デューティ サイクル

速度変更

モーター動作中、DIN が変化すると、MC121 はユーザーが設定したランプ レートを使用して、出力デューティ サイクル (図 6-2 の DOUT) を前の目標デューティ サイクル (DOUT_TARGET_PREV) から新しい目標デューティ サイクル (DOUT_TARGET) までスムーズに変化させます。加速中 (DOUT_TARGET > DOUT_TARGET_PREV) は、ランプ レートは PWM_RAMP_SEL によって設定され、減速中 (DOUT_TARGET < DOUT_TARGET_PREV) は、ランプ レートは PWM_RAMP_SEL (PWM_DECEL_SEL = 0x0 の場合) または 0.5x PWM_RAMP_SEL (PWM_DECEL_SEL = 0x1 の場合) になります。PWM_DECEL_SEL = 0x1 は、モーターからの回生エネルギーのプッシュバックによる DC バス スパイクを回避するため、減速中にランプを遅くします。図 6-7 に、PWM_RAMP_SEL に従う DOUT の増加および減少の例を示します。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

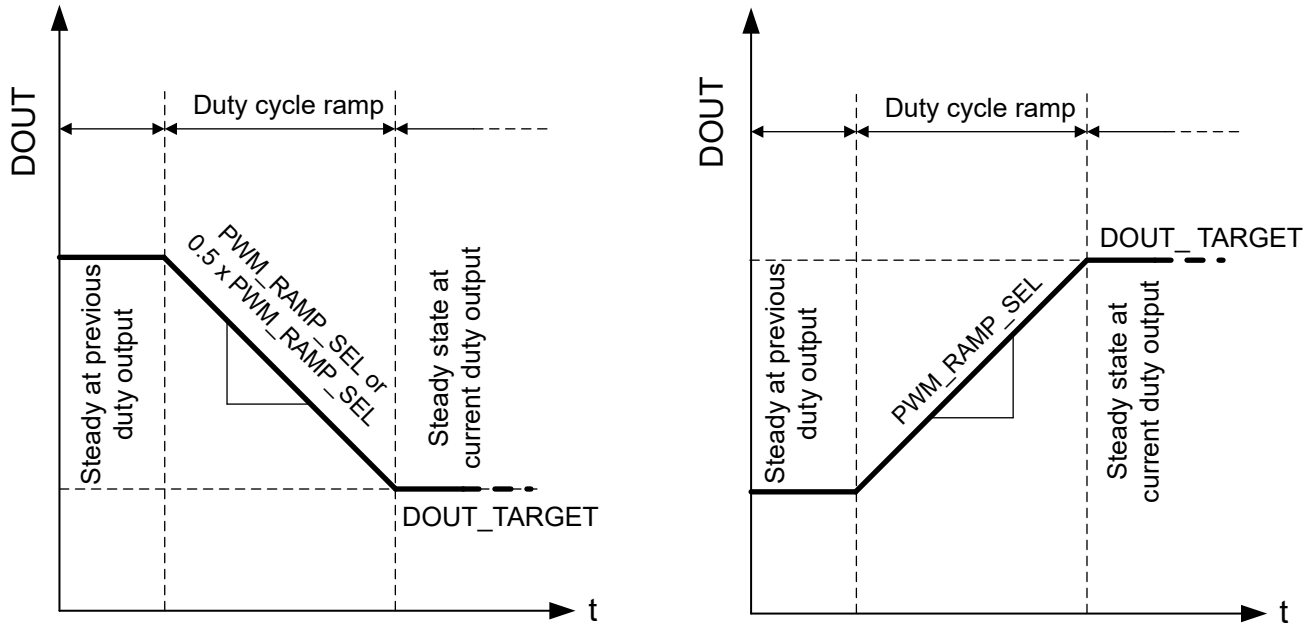


図 6-7. デューティ サイクルのランプ

モーターの停止

モーター停止 (DOUT_TARGET = 0%) を受信すると、MC121 は RAMP_ON_STOP_DIS の設定に基づいてモーターを停止します。RAMP_ON_STOP_DIS が 0x1 に設定されている場合、モーター停止が検出されると (t_{STOP_DET} 以内に)、すべての FET がハイ インピーダンスになります。RAMP_ON_STOP_DIS が 0x0 に設定されている場合、デバイスは DOUT を PWM_DECEL_SEL で設定されたレートでゼロまでランプ ダウンし、その後すべての FET をハイ インピーダンスにします。FET がハイ インピーダンスになると、STBY_EN および SLEEP_EN の設定に応じて、MC121 はアクティブ状態またはスタンバイ状態を継続するか、低消費電力スリープ状態に移行します。図 6-8 に、DOUT_TARGET が 0% に設定されている場合のモーター停止シーケンスを示します。

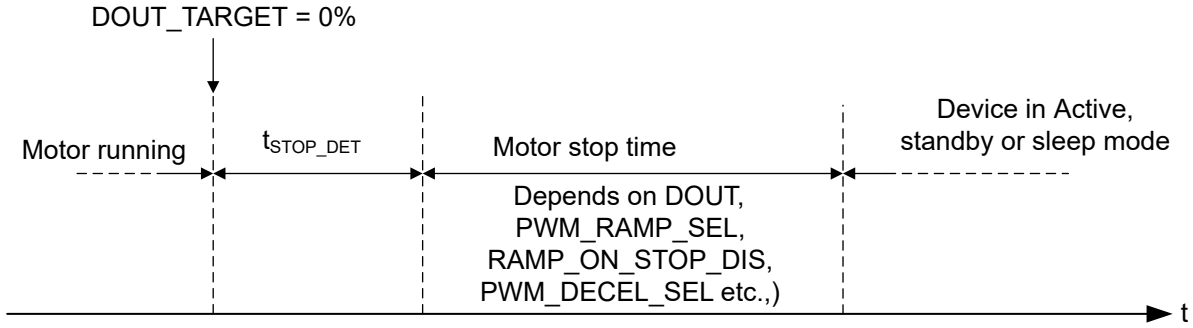


図 6-8. DOUT_TARGET = 0% の場合のモーター停止シーケンス

注

PWM_RAMP_EN ビットを 0x0 に設定すると、デューティ サイクルのランプは無効化されます。デューティ サイクルのランプを無効にすると、DOUT にステップ変化が生じ (DIN 変化時)、モーターの位相電流や DC バス電圧スパイクが大きくなる可能性があります。電流または電圧スパイクを回避するため、PWM_RAMP_EN を 0x1 に設定することを推奨します。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

6.3.1.4 開ループ (デューティ サイクル) 制御

開ループ制御モード (SPEED_LOOP_EN を 0x0 に設定) では、内部入力デューティ信号 (DIN)、デューティ曲線、デューティ ランプ出力 (DOUT) によって、整流波形のピーク出力デューティ サイクル (OUTx ピンに印加されるモーター位相電圧) が決まります。MC121 の開ループ動作モードのブロック図を図 6-9 に示します。H ブリッジ FET に印加される、電気的半サイクルのデューティ サイクルは、整流モード (COMMUTATION_MODE) と変調モード (PWM_MODE) の設定で決まります。

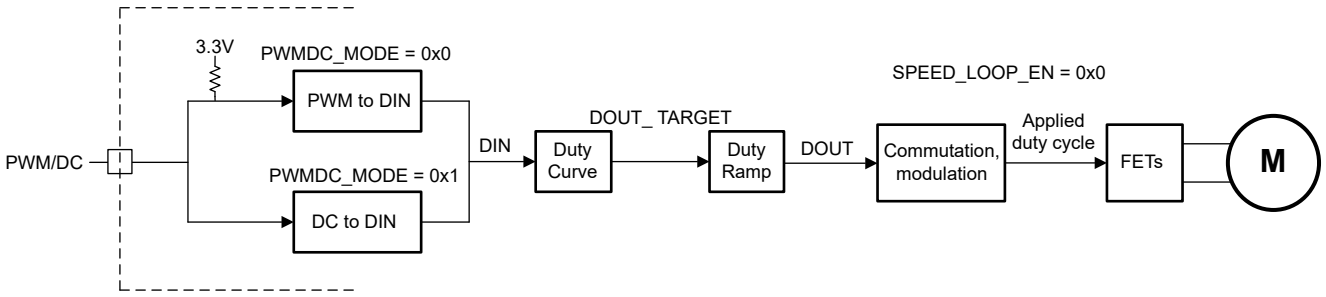


図 6-9. 開 (デューティ) ループ制御

6.3.1.5 閉ループ (速度) 制御

図 6-10 に示す通り、MC121 には閉ループ (速度) 制御モードがあり、各種動作条件 (VM、負荷) で一定の速度を維持するために使用できます。速度ループは、SPEED_LOOP_EN を 0x1 に設定し、速度リファレンス / 目標 (SPEED_REF) を (DOUT × MAX_SPEED) によって設定することで有効化されます。内蔵ホール センサからのモーター速度フィードバックが SPEED_REF と比較され、誤差は PI ループに供給されます。PI ループ Kp および Ki 係数は、KP_RATIO と KI_RATIO によって設定されます。速度ループの出力 (DOUT_SPEED_LOOP) は、印加されるピーク デューティ サイクルを設定します。速度ループの出力 (DOUT_SPEED_LOOP) が飽和すると、積分ワインドアップを防止するため、積分器が無効化されます。

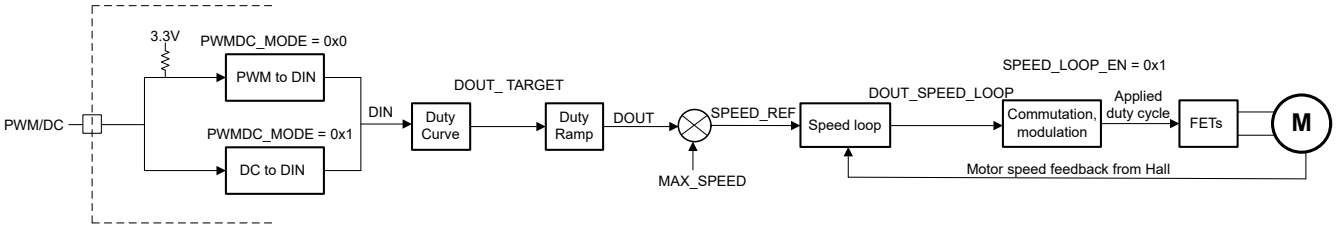


図 6-10. 閉ループ (速度) 制御

6.3.1.6 整流

モーターにおける整流とは、固定子と回転子の磁場の向きを設定し、連続的な回転子の動作を維持するプロセスです。単相 BLDC モーターの回転子には、N 極と S 極が交互に切り替わる永久磁石が含まれています。固定子には 1 相の巻線があり、通電時に回転子の磁極を引き付けたり反発させたりします。MC121 に内蔵されたホール センサは、モーターの整流のために固定子巻線に流す電流の方向を決定します。MC121 を使用した単相モーター整流の例を、図 6-11 に示します。適切なモーターの整流には、MC121 を 2 つの固定子極の間に配置し、ホール素子が回転子磁石の直下に位置するようにする必要があります。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

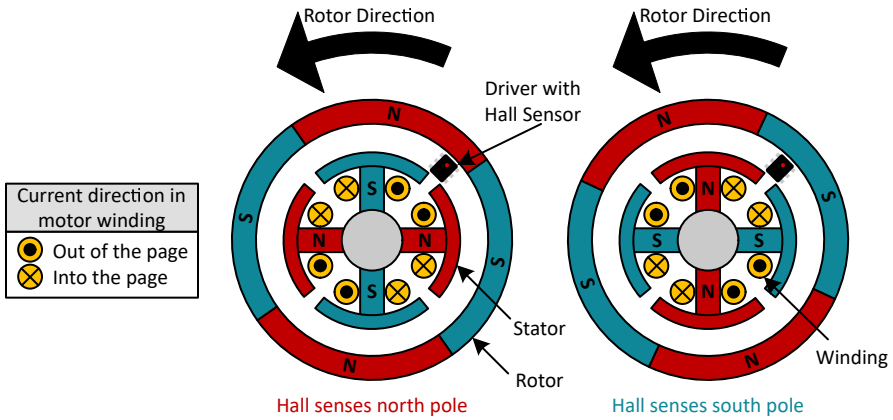


図 6-11. 単相モーター整流の例

MC121 ドライバは、単相 BLDC モーター整流のために以下の機能を内蔵しています。

- 回転子の位置センシング用のデジタル ラッチ ホール センサ
- HALL_OS_ANGLE ビットと HALL_ANGLE_MODE ビットを使用した、リードまたはラグ角度を調整するためのホール センサ オフセット角度の設定
- HALL_OS_TIME ビットと HALL_TIME_MODE ビットを使用した、リードまたはラグ時間を調整するためのホール センサ遅延の設定。
- HALL_INVERT ビットによるホール ラッチ センサ出力の反転により、モーター回転方向の変更やホール センサの各種の向きに対応
- COMMUTATION_MODE ビットで、方形波とソフトの PWM デューティ サイクル波形の選択

6.3.1.6.1 ホール センサ

MC121 はデジタルラッチ ホール センサを内蔵しており、回転子の位置情報を整流アルゴリズムに提供します。以下のセクションでは、整流アルゴリズムに対するデバイスの向きと内部ホール信号の詳細を説明します。

6.3.1.6.1.1 磁界方向の定義

ホール センサは、図 6-12 に黄色で示されたホール センサの表面から磁束が外側へ向かう場合に、正の磁界 (B > 0mT) を検出します。SOT-23 フラット リード パッケージはフリップチップ構造を使用しているため、ホール センサの表面は回転子の磁石方向を向いています。この方向では、パッケージの下を N 極が通過すると、ホール センサは正の磁界を検出します。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

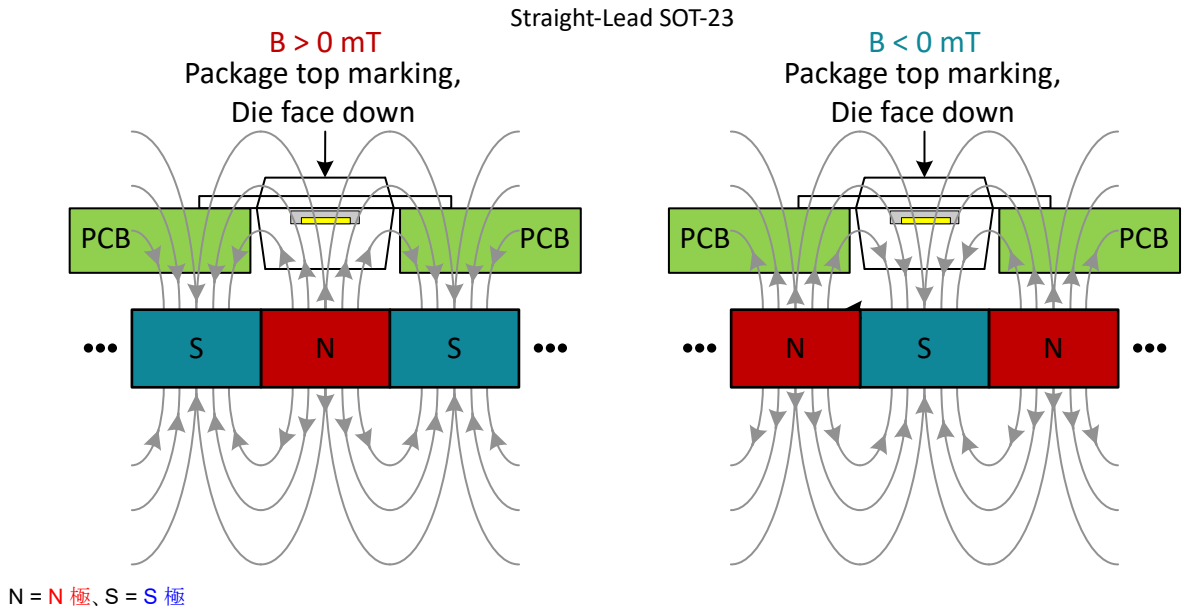


図 6-12. 回転子磁石とドライバを基準とした磁界方向の定義

6.3.1.6.1.2 内部ホール ラッチ センサ出力

B_{RP} と B_{OP} の間の磁界強度で本デバイスを電源オンすると、内部ホール ラッチ出力信号は不定となります。磁界強度が B_{OP} を上回ると、内部ホール ラッチ出力信号は Low になります。磁界強度が B_{RP} を下回ると、内部ホール ラッチ出力信号は High になります。

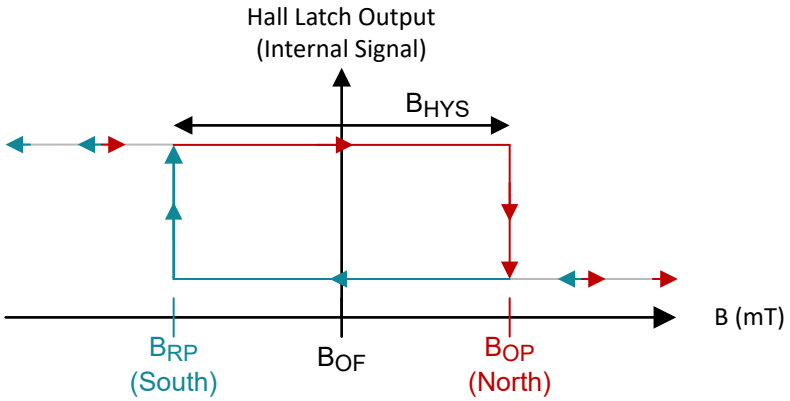


図 6-13. 内部ホール出力信号

6.3.1.6.2 ホール オフセット

MC121 には、逆起電力 (back-EMF) のゼロ交差に対するホール センサ (MC121 内) の相対位置に起因する、ホール ラッチ センサ出力と整流のオフセットを補正するためのオプションがあります。HALL_OS_ANGLE を使用すると、0º から 43.6º までの範囲で、1.4º 刻みでホール オフセット角度の大きさを設定できます。ホール ラッチ出力に対する整流オフセットの極性 (整流がホール ラッチ遷移に先行するか、整流がホール ラッチ遷移に遅れるか) は、HALL_ANGLE_MODE を使用して設定できます。

モーター位相電流を逆起電力 (back-EMF) に合わせることで速度全域でのモーター効率を最大化するには、ホール センサ出力に対して整流のリード時間またはラグ時間を設定する必要があります。リード/ラグ時間 ($t_{HALL_OS_TIME}$) は、HALL_OS_TIME の 0 ～ 2.6ms (10µs 単位) で設定できます。この時間の極性 (整流がホール ラッチ遷移に先行するか、整流がホール ラッチ遷移に遅れるか) は、HALL_TIME_MODE を使用して設定できます。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

MC121 は、HALL_OS_ANGLE、HALL_ANGLE_MODE、HALL_OS_TIME、HALL_TIME_MODE に基づいて適用の必要があるリード時間またはラグ時間の合計 (t_{HALL_OS}) を算出し、計算されたリード時間またはラグ時間を整流領域で適用します。たとえば、HALL_OS_ANGLE が –15.4°、HALL_OS_TIME が 150µs に設定され、モーターが 500Hz で動作している場合、適用されるリード時間は約 64.5µs です。500Hz での 15.4° は 85.5µs に相当するので、実効リード / ラグ時間 (t_{HALL_OS}) は (150 - 85.5)µs = 64.5µs になります。

6.3.1.6.3 方形波整流

方形波整流は、MC121 によって実現されるシンプルな整流方式で、最大のトルク / 速度動作を可能にします。図 6-14 に、方形波整流におけるホール センサ信号に対するドライバ出力電圧を示します。

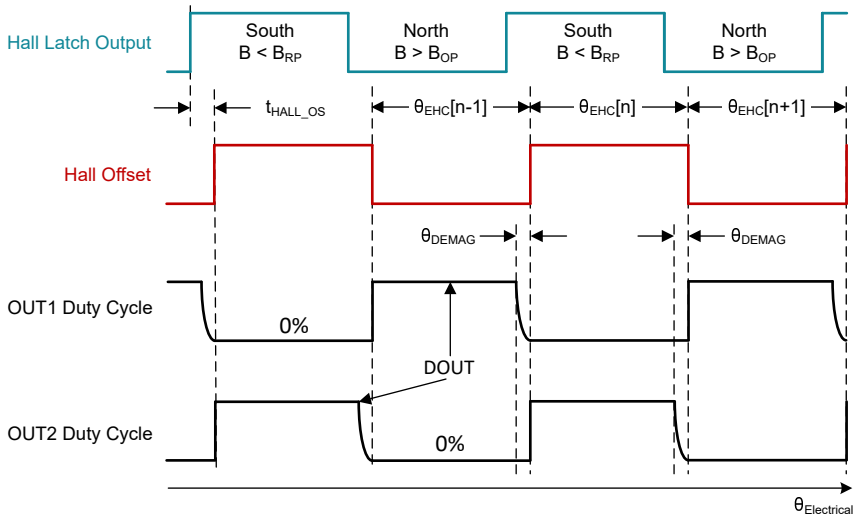


図 6-14. 方形波整流のタイミング波形

方形波整流では、出力デューティ サイクルは、電気的角度 ($\theta_{Electrical}$) に対して DOUT で一定に維持されます。ホール センサと HALL_INVERT ビットからの信号によって、指令されたデューティ サイクルでスイッチングする OUTx 端子と、180° 電気的半サイクル (θ_{EHC}) の間に GND にプルダウンされる OUTx 端子が決定されます。

消磁状態 θ_{DEMAG} は、電気的半サイクルの終了時に発生し、DEMAG_TIME ビットによって決定されます。消磁の目的は、整流イベントにより OUTx 電圧の極性を反転させる前に、モーター電流をゼロに低減し、固定子巻線を消磁することです。消磁により、整流中の VM 電源と OUTx の電圧スパイクが最小限に抑えられます。消磁は、back-EMF が最小となる整流領域周辺でのモーター電流スパイクを低減することで、効率も向上させます。

消磁時間 (DEMAG_TIME) は固定時間に設定することも、自動的に決定することもできます。AUTO_DEMAG_EN が 0x0 に設定されている場合、消磁時間は動作条件全体にわたって一定であり、DEMAG_TIME ビットによって、モーター始動時および定常状態のモーターの速度に基づいて θ_{DEMAG} が決定されます。AUTO_DEMAG_EN が 0x1 に設定されている場合、プリスタート フェーズ後、ドライバは θ_{DEMAG} 角度を自動的に調整し、DEMAG_TIME で設定されたモーターの速度に基づいて消磁時間を最適化します。

6.3.1.6.4 ソフト整流

ソフト整流方式では、整流イベント後、立上り角 θ_{SRISE} の間に PWM デューティ サイクルが DOUT までランプ アップし、立下り角 θ_{SFALL} の間に 0% にランプ ダウンします (図 6-15 を参照)。ソフト整流の目的は、方形波整流に比べて音響ノイズを低減することです。電気的半サイクルにおける θ_{SRISE} および θ_{SFALL} 角度の期間は、ホール センサ信号の遷移タイミングによって決定されます。θ_{SRISE} および θ_{SFALL} の角度は、SRISE および SFALL ビットを使用してプログラムできます。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

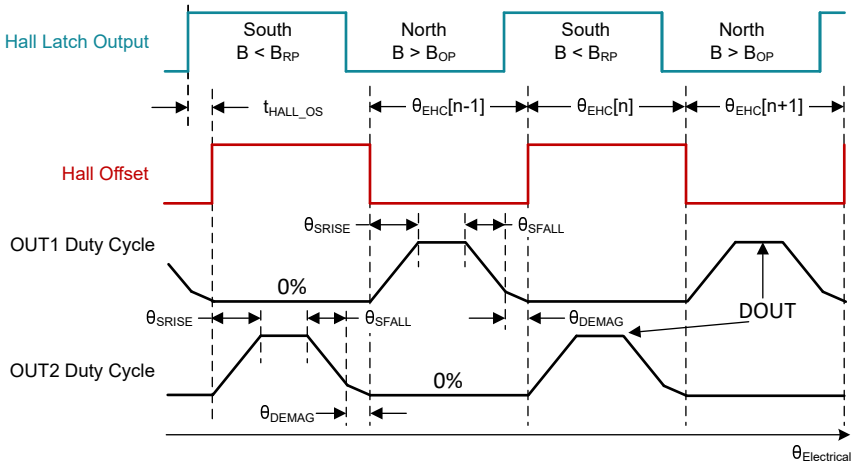


図 6-15. ソフト整流のタイミング波形

SRISE、SFALL、DEMAG_TIME ビットをプログラミングする際、θ_{SRISE}、θ_{SFALL}、θ_{DEMAG} の合計が 180° を超えると、θ_{SRISE} の角度が減少します。

6.3.1.7 PWM 変調モード

MC121 には、同期、非同期、ハイブリッドの 3 種類の PWM 変調モードがあります。PWM_MODE ビットは、セクション 6.3.1.7 で説明されているように、PWM オフ時間および θ_{DEMAG} 時間中のモーター電流のハイブリッド、同期、非同期の変調を設定します。図 6-16、図 6-17、図 6-18 は、それぞれ θ_{DEMAG} 中の非同期、同期、およびハイブリッド再循環状態のタイミング図を示します。

同期モードでは、PWM オフ時間中に両方のローサイド FET がオンになります。また、フリーホイール電流をボディ ダイオードではなく FET を通して導通することで、電力損失を低減します。ただし、ターンオフ電流やモーター巻線インダクタンスによっては、同期変調中に逆電流が流れ、負トルクが発生してモーター速度が低下する場合があります。

非同期モードでは、PWM オフ時間中に 1 つのローサイド FET だけがオンに維持され、その他の FET は無効化されます。フリーホイール電流は、もう 1 つのローサイド FET のボディ ダイオードを通して導通されます。非同期モードでは、PWM オフ時間中に逆電流は流れませんが、ボディ ダイオード導通により、電力損失が大きくなる可能性があります。

MC121 はハイブリッド変調方式を採用しており、両方のモードを組み合わせてフリーホイール時の電力損失を低減し、逆電流を防止します。

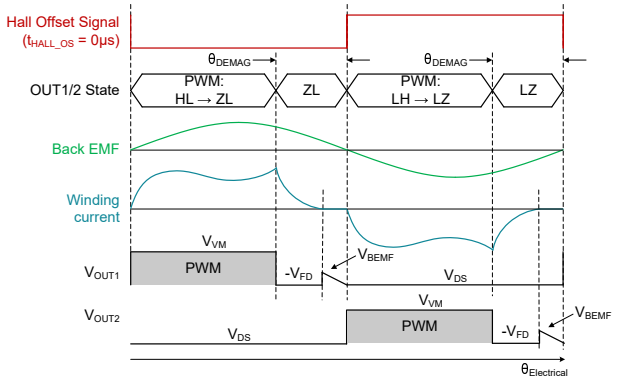


図 6-16. θ_{DEMAG} における非同期モードを使用した方形波整流の詳細なタイミング図

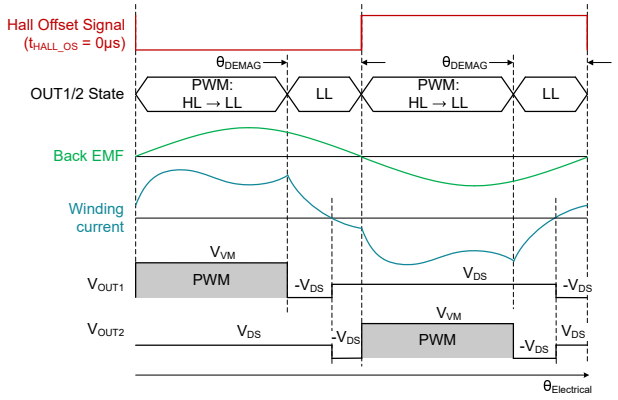


図 6-17. θ_{DEMAG} における同期モードを使用した方形波整流の詳細なタイミング図

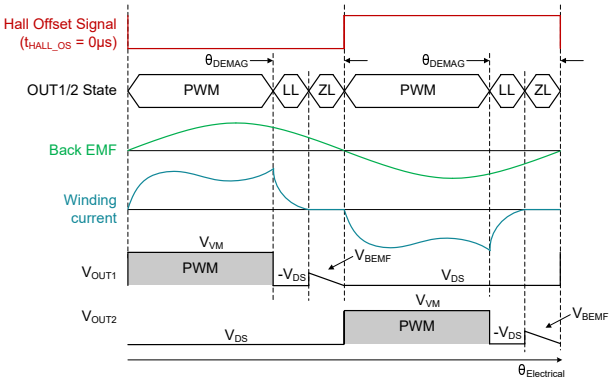


図 6-18. θ_{DEMAG} におけるハイブリッド モードを使用した方形波整流の詳細なタイミング図

表 6-1 は、出力 PWM の H ブリッジ状態を示します。H は該当 OUTx レッグのハイサイド FET がオン、L はローサイド FET がオン、Z はその OUTx レッグの両方の FET がハイ インピーダンスです。ホール オフセット信号は、ホール センサの状態およびデバイス設定から決定される内部信号です。ホール オフセット信号によって、整流アルゴリズムのステート マシン内での出力スイッチング状態が決定されます。入力 PWM のデューティ サイクルと、整流モード (方形波またはソフト) によって、出力 PWM の瞬時デューティ サイクル DOUT が決まります。

表 6-1. 出力状態の表

ドライバ状態	説明	PWM_MODE によって設定される変調モード	ホール オフセット信号	OUT1	OUT2
DOUT	デューティ サイクルあたりの PWM オン時間	X	L	L	H
		X	H	H	L
(1-DOUT)、電流制限、θ_{DEMAG}	PWM オフ時間 (デューティ) 中、電流制限オフ時間中、または整流イベント前の位相消磁時間中におけるモーター電流の再循環	非同期モード	L	L	Z
			H	Z	L
		同期モード	X	L	L

図 6-19 は、PWM オン時間、PWM オフ時間、および消磁状態における H ブリッジを流れるモーター電流を示しています。消磁状態の詳細については、セクション 6.3.1.6.3 を参照ください。

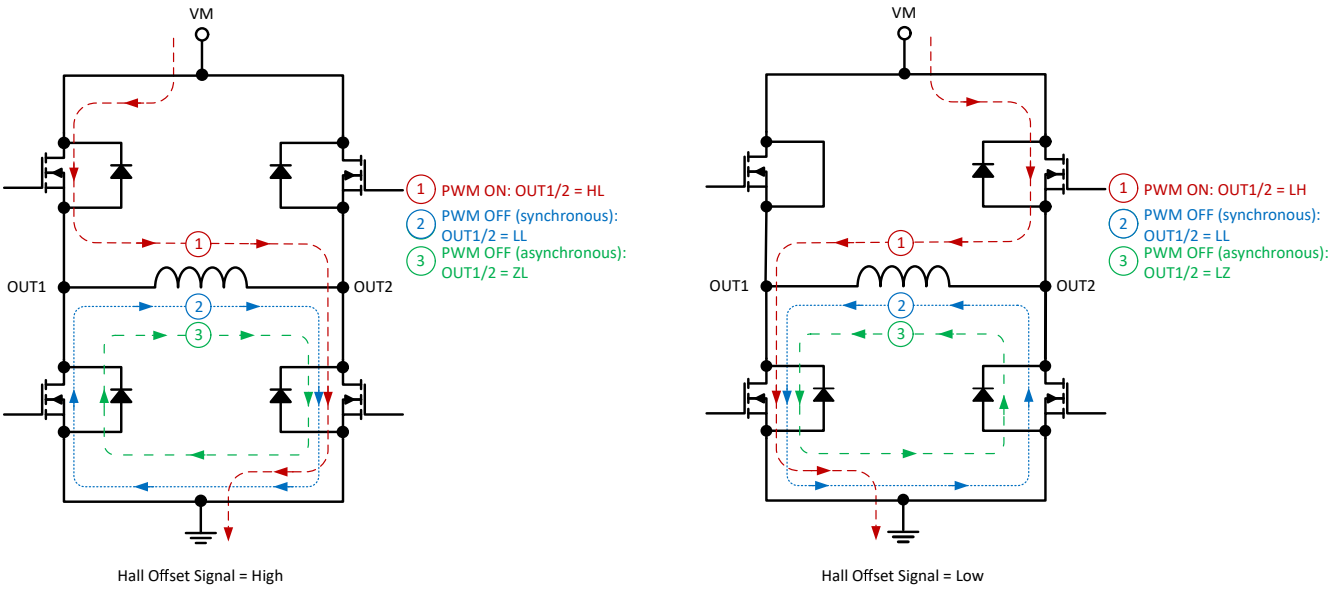


図 6-19. モーター電流と出力状態

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

ハイブリッド PWM モードでは、PWM オフ時間中 (同期モードと同様) に両方のローサイド FET を有効にすることで、ボディ ダイオードを通したモーター電流の再循環を防止します。A のゼロ電流検出器は、該当するローサイド FET を無効化して H ブリッジを非同期モードにし、逆電流を防止します。MC121 は、各 PWM サイクル中に同期モードと非同期モードを自動的に切り替えることで、デバイスの電力損失を低減するとともに、逆起電力 (back-EMF) による意図しない負電流がモーター巻線に流れることを防ぎます。

表 6-2 は、PWM 変調モードを構成するための PWM_MODE ビットの設定を示しています。

表 6-2. PWM_MODE による変調モード

PWM_MODE ビット	PWM および電流制限オフ時間	消磁状態
000b	ハイブリッド	ハイブリッド
001b	ハイブリッド	非同期
010b	非同期	ハイブリッド
011b	同期	ハイブリッド
100b	同期	同期
101b	同期	非同期
110b	非同期	同期
111b	非同期	非同期

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

6.3.2 保護

MC121 は、回転子ロック、電流制限、過電流、VM 低電圧、VM 過電圧、過熱イベントに対する保護機能を内蔵しています。表 6-3 に、故障モードの開始とアクティブ モードへの復帰の条件を示します。

表 6-3. デバイスの故障時の動作および応答

フォルト	条件	H ブリッジ	デバイス ロジック	FG/RD ピンの故障通知があるか	復帰
回転子ロックの保護	t_{LRD} の間ホール遷移が検出されず、LRD_RETRY_DIS = 0x0	すべての FET が無効化 (ハイ インピーダンス)	有効	あり	$t_{lock_long_retry}$ または $t_{lock_quick_retry}$ 後に自動リトライ
	5 回連続の起動試行で、t_{LRD} の間ホール遷移が検出されず、LRD_RETRY_DIS = 0x1	すべての FET が無効化 (ハイ インピーダンス)			ラッチされる。ラッチされた故障は電源リセットまたはウェークアップによってのみクリアされる
電流制限	I_{OUTx} (ロー サイド) > I_{LIMIT}	PWM_MODE に基づいて HS FET を無効化し、ロー サイド FET を介した電流再循環を行う		なし	次の出力 PWM デューティ サイクルの開始時に I_{OUTx} (ロー サイド) < I_{LIMIT}
過電圧保護	V_{VM} > V_{OVP} (立ち上がり)、OVP_EN = 0x1	すべての FET が無効化 (ハイ インピーダンス)		あり (FGRD_FAULT_SEL = 0x1 の場合) なし (FGRD_FAULT_SEL = 0x0 の場合)	V_{VM} < V_{OVP} 立ち下がりスレッショルド
過電流保護	I_{OUTx} > I_{OCP} および OCP_MODE = 0x0	すべての FET が無効化 (ハイ インピーダンス)			$t_{lock_long_retry}$ 後に自動リトライ
	I_{OUTx} > I_{OCP} および OCP_RETRY_MODE = 0x1				4 回連続の OCP イベント後にラッチされる。ラッチされた故障は電源リセットまたはスリープからのウェークアップによってのみクリアされる
サーマル シャットダウン	T_J > T_{TSD}	すべての FET が無効化 (ハイ インピーダンス)			T_J < T_{TSD} - T_{HYS}
低電圧保護	V_{VM} < V_{UVLO} (立ち下がり)	すべての FET が無効化 (ハイ インピーダンス)	無効		V_{VM} > V_{UVLO} 立ち上がりスレッショルド
内蔵電源クランプ	V_{VM} > V_{CLAMP} および VM_CLAMP_DIS = 0x0	HS FET 無効化 (ハイ インピーダンス)	有効	なし	V_{VM} < V_{CLAMP}

FG/RD ピンは、モーター速度、回転子ロック、または故障を検出するために、ファン コントローラへのフィードバックをサポートしています。FGRD_MODE ビットを 0x0 に設定すると、周波数ジェネレータ (FG) 出力の FG/RD ピンが設定されます。内部ホール センサ信号の遷移によって、FG 信号の周波数が決まります。FG_MULTIPLIER ビットを設定することで、FG ピンは内部ホール センサ周波数の 1/2、1、2/3、または 2 倍の係数でトグルします。FG_MULTIPLIER ビットは、異なる数の磁極ペアまたは位相を持つモーターをスワップする際に、システム設計とファームウェアの変更を最小限に抑えるのに役立ちます。FG_HALL_RAW_EN が 0x0 に設定されている場合、FG ピンの信号は周波数ジェネレータ (FG) 出力に使用されるホール オフセット信号に対応します。FG_HALL_RAW_EN = 0x1 の場合、FG ピンの信号はホール ラッチ センサ信号出力に対応します。MC121 は、FG_HALL_RAW_EN = 0x1 の場合、FG_MULTIPLIER 設定をサポートしません。

FG/RD ピンは、表 6-4 に従って、回転子ロックの状態、デバイスの故障、アクティブ モード ステータスを示します。モーターが停止 / アイドル状態 (DIN = 0% または DOUT_TARGET = 0% によって停止) のときの FG ピンの状態は、回転子ロックまたはデバイスの故障状態を示すために使用される状態とは常に逆になります。たとえば、FGRD_MODE、FGRD_INVERT、FGRD_FAULT_SEL ビットの組み合わせにより、回転子ロックが FG ピンのアクティブ Low 信号で示される場合、モーターが停止 / アイドル状態のときの FG ピンの状態は (外部プルアップによって) High になります。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

故障状態は TEST_FAULT および TEST_FAULT_STATUS レジスタで通知されます。TEST_FAULT レジスタはアクティブな故障のリアルタイムのステータスを提供します。TEST_FAULT_STATUS レジスタには、ホストによってクリアされるまで持続する故障インジケータが含まれます。

表 6-4. FG/RD ピンの動作

FGRD_MODE ビット	FGRD_INVERT ビット	FGRD_FAULT_SEL ビット	アクティブ モード表示	回転子ロック故障通知	OVP、OCP、TSD、UVLO の故障通知
0x0	0x0	0x0	4 ホール遷移後のトグル	Low にアサート	該当なし
	0x0	0x1			Low にアサート
	0x1	0x0	4 ホール遷移後の反転トグル	High にプル	該当なし
	0x1	0x1			High にプル
0x1	0x0	0x0	High にプル	Low にアサート	該当なし
		0x1			Low にアサート
	0x1	0x0	Low にアサート	High にプル	該当なし
		0x1			High にプル

6.3.2.1 回転子ロックの保護

MC121 回転子ロックの保護機能があり、回転子ロック検出時間 (t_{LRD}) を超える時間、ホール遷移が検出されない場合、すべての FET (ハイ インピーダンス)を無効化します。回転子ロック故障が認識され、表 6-4 に従って FG/RD ピンが回転子ロック故障を示します。起動シーケンス中の t_{LRD} は t_{LRD_START} によって設定され、モーター動作中 (定常状態) の t_{LRD} は t_{LRD_RUN} によって設定されます。起動中の回転子ロック リトライ シーケンス (LRD_RETRY_DIS = 0x0 の場合) を、図 6-20 に示します。

電源投入またはスリープからのウェークアップ後に最初に起動する際のクイック リトライの回数は LRD_NRETRY_STARTUP によって設定されます。クイック リトライ時間は、回転子ロックの検出時間 (t_{LRD_START}) と同じです。LRD_NRETRY_STARTUP 回のリトライが完了しても回転子ロックの状態が続く場合、MC121 はロング リトライ時間 ($t_{lock_long_retry}$) に移行します。これは LRD_LONG_RETRY_SEL x t_{LRD_START} によって設定されます。ロング リトライ時間が経過すると、MC121 はモーターの回転を再度試みます。その後のモーター起動リトライで、クイック リトライの回数は LRD_NRETRY_RUN によって設定されますが、回転子ロックの検出時間 (t_{LRD_START}) とクイック リトライ時間は変更されません。LRD_NRETRY_RUN のリトライが完了しても回転子ロック状態が続くと、MC121 はロング リトライ時間 ($t_{lock_long_retry}$) に再び入ります。その後のモーター起動シーケンスでは、2 番目の起動リトライ サイクルと同じリトライ パターンが使用されます (図 6-20 を参照)。リトライ時間が経過した後の各モーター起動 (クイックまたはロング リトライ) は、プレスタート フェーズから開始されます (図 6-6 を参照)。

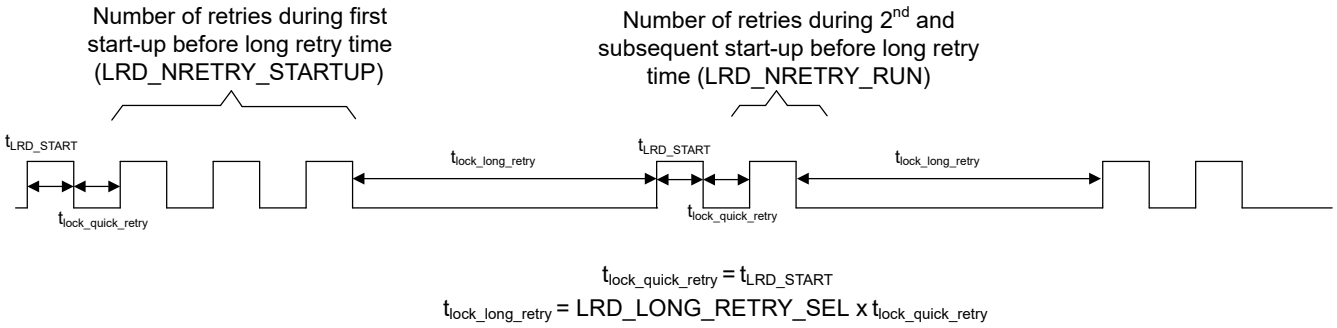


図 6-20. 起動中の回転子ロック リトライ シーケンスおよびタイミング (LRD_RETRY_DIS = 0x0 の場合)

定常状態でモーター動作中に回転子ロック状態が検出された場合 (t_{LRD_RUN} の間ホール遷移がない場合)、すべての FET は無効化され (ハイ インピーダンス)、FG/RD ピンは、表 6-4 に従って回転子ロックの故障を示します。モーター動作中に回転子のロック状態が検出された場合のリトライ回数は LRD_NRETRY_RUN によって設定されます。MC121 は、回転子ロックのリトライ シーケンスを再び開始する前に、ロング リトライ時間の 1 回分を待機します (図 6-21 を参照)。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

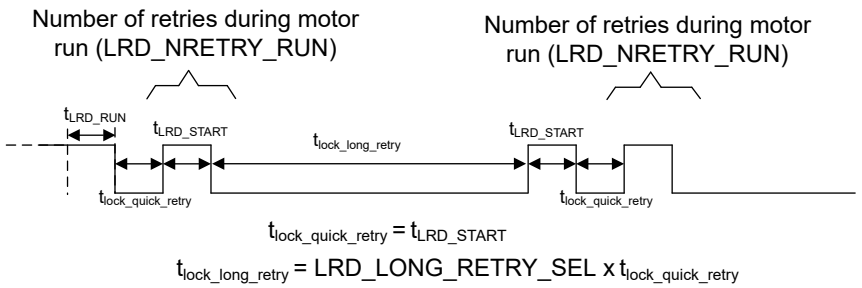


図 6-21. 実行中の回転子ロック リトライ シーケンスおよびタイミング (LRD_RETRY_DIS = 0x0 の場合)

MC121 には、図 6-22 に示すように、LRD_RETRY_DIS = 0x1 を設定することで、5 回連続の起動試行が回転子ロックとなった際に、回転子ロックの故障をラッチするオプションが用意されています。モーター動作は、電源リセットまたはウェークアップ (スリープ終了) によって再開できます。

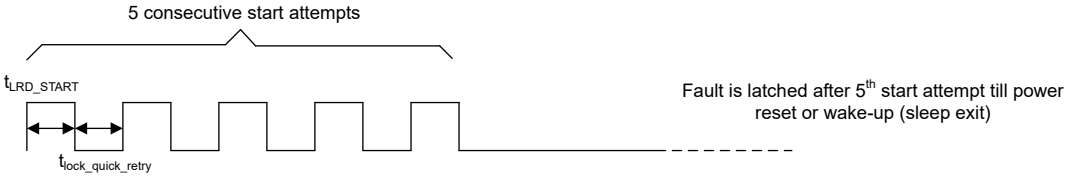


図 6-22. 回転子ロック リトライ シーケンスおよびタイミング (LRD_RETRY_DIS = 0x1 の場合)

6.3.2.2 電流制限

MC121 は、設定可能な出力電流制限機能を提供し、スタートアップ、過負荷、ストール状態時の過電流動作からモーターを保護します。モーター位相電流が I_{LIMIT} スレッショルドを超えると、MC121 はハイサイド FET をオフにすることで、サイクル単位の電流制限方式を適用します。ILIMIT_SEL は電流制限スレッショルドを設定します。PWM_MODE ビットは、セクション 6.3.1.7 に記載されている PWM オフ時間と同様に、電流制限オフ時間中のモーター電流の同期、非同期、またはハイブリッド再循環状態を設定します。

次の PWM 周期の開始時点でもモーター電流が I_{LIMIT} スレッショルドを上回っている場合、ローサイド FET は別の PWM 周期にわたり有効状態が維持されます。次の PWM 周期の開始までにモーター電流が I_{LIMIT} を下回ると、出力は、表 6-1 に示すように、整流アルゴリズム ステート マシンによって決定される駆動状態に戻ります。

電流制限は、モーター電流が I_{LIMIT} スレッショルドを上回った場合に出力 PWM デューティ サイクルを下げることで、モーター トルクの上限を設定します。この電流制限機能は、整流ステート マシンによって決定される PWM デューティ サイクルよりも優先されます。モーター電流が I_{LIMIT} スレッショルドを下回ると、整流ステート マシンが出力デューティ サイクルを完全に制御します。図 6-23 および 図 6-24 に、サイクル単位の電流制限方式の波形例を示します。

MC121 は、各 PWM の開始時に I_{LIMIT} に設定可能なブランキング時間を適用します。ブランキング時間は、ILIM_BLANK_SEL ビットを設定することで設定できます。I_{LIMIT} は、設定可能なグリッチ除去時間も備えています。グリッチ除去時間は、ILIM_DEGLITCH_SEL ビットで設定できます。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

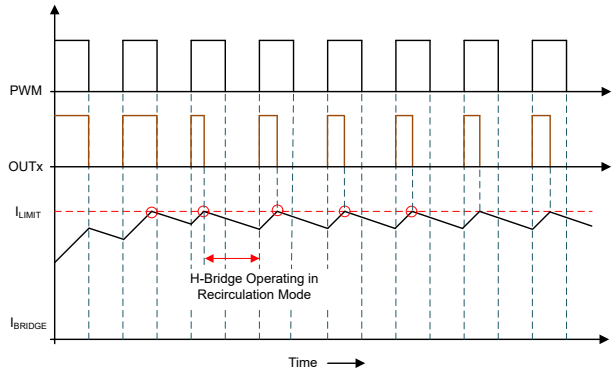


図 6-23. サイクル単位の電流制限動作

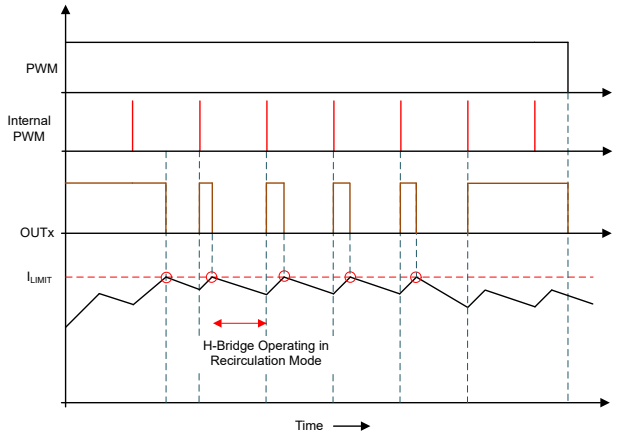


図 6-24. 100% PWM デューティ サイクルでのサイクル単位の電流制限動作

6.3.2.3 過電流保護 (OCP)

MC121 は、過電流保護 (OCP) 機能を備えているため、OUTx ピンの内蔵パワー FET を電源 (VM)、グランド、OUTx ピン間の短絡から保護します。図 6-25 に示すように、FET に流れる電流が OCP スレッショルド (I_{OCP}) を上回る状態が OCP グリッチ除去時間 (t_{OCP}) を超えて続くと、H ブリッジ内のすべての FET が無効化 (ハイ インピーダンス) され、FG/RD ピンは 表 6-4 に示すように故障を示します。OCP 故障の復帰は、OCP_RETRY_MODE によって設定されます。

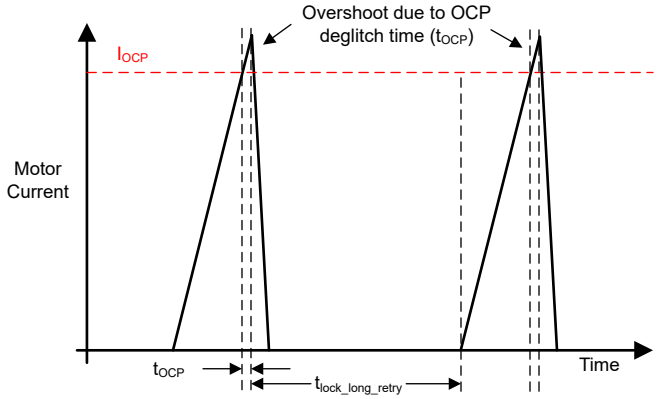


図 6-25. OCP 動作

OCP_RETRY_MODE が 0x0 に設定されている場合、図 6-26 に示すように、MC121 は $t_{lock_long_retry}$ が経過すると (プリスタート フェーズから) モーターの駆動を開始します。$t_{lock_long_retry}$ は、(LRD_LONG_RETRY_SEL × t_{LRD_START}) によって設定されます。OCP_RETRY_MODE が 0x1 に設定されている場合、MC121 は、3 回のリトライ (リトライ時間は $t_{lock_long_retry}$ で設定される) または 4 つの OCP イベントの後に故障をラッチします。その後のモーター動作は、電源リセットまたはウェークアップ (スリープ終了) で故障状態をクリアした後のみ、可能になります。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

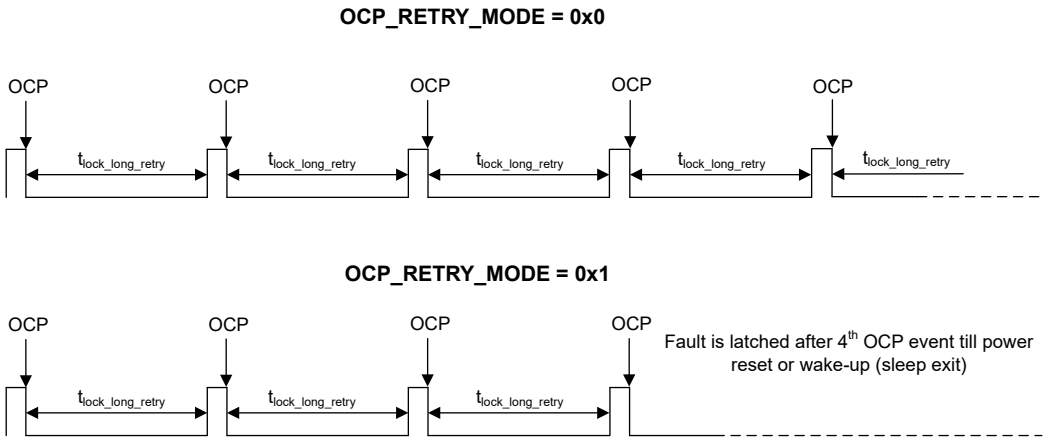


図 6-26. OCP リトライ モード

6.3.2.4 VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)

MC121 には低電圧誤動作防止機能があり、VM ピンの電圧が UVLO の立ち下がりスレッショルド電圧 V_{UVLO} を下回った場合、デバイスのすべての回路を無効にします。VM がパワーオン リセット (VM_{POR}) の立ち下がりスレッショルドを下回ると、内部ロジックはリセットされます。UVLO_SEL = 0x0 の場合、図 6-27 に示すように、V_{VM} 電圧が UVLO の立ち上がりスレッショルドを上回ると、デバイスがパワーアップしてモーター動作が再開します。UVLO_SEL ≠ 0x0 の場合、デバイスは常に UVLO_SEL = 0x0 に対応する UVLO 立ち上がりスレッショルドでパワーアップしますが、モーター動作は、VM が UVLO_SEL ビットで設定された UVLO 立ち上がりスレッショルドを上回った場合にのみ開始されます。UVLO_SEL ≠ 0x0 および 3.15 < VM < V_{UVLO} (立ち上がり) (UVLO_SEL の設定に対応) の場合、VM UVLO の故障がアクティブになり、すべての FET が無効化され、FG/RD ピンは表 6-4 に従って故障を通知します。

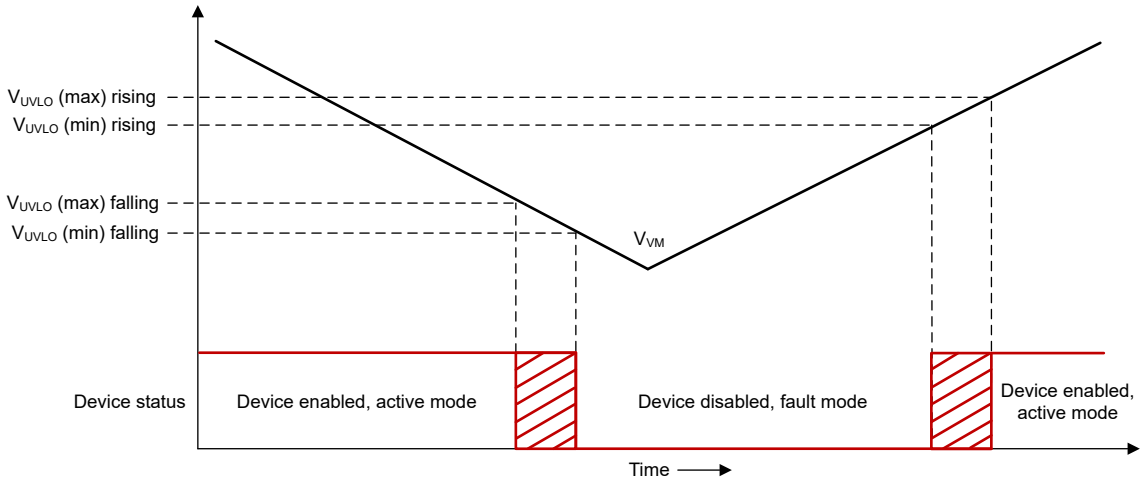


図 6-27. VM UVLO の動作

6.3.2.5 VM 過電圧保護 (OVP)

MC121 は、VM 電圧が V_{OVP} 立ち上がりスレッショルドを超えると、すべての FET (ハイ インピーダンス) を無効化する過電圧保護機能を備えています。FG/RD ピンは、表 6-4 に従い故障を通知します。VM 電圧が V_{OVP} 立ち下がりスレッショルドを下回ると、デバイスは通常動作を再開します。OVP スレッショルドは OVP_SEL で設定され、OVP_EN を 0x1 に設定することで有効化できます。OVP_EN = 0x1 の場合、加速または減速中に速度コマンド (DOUT_TARGET) の変化が検出されると、OVP がブランキングされます。

OVP には 70µs の固定グリッチ除去時間があり、スプリアス OVP トリガを防止します。通常のモーター動作時の過渡的な VM スパイクによる OVP の誤検出を避けるため、ソフト整流の立ち上がりおよび立ち下がり区間では過電圧保護が無効

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

化されています。また、消磁区間中は OVP が常に無効化されています。MC121 には、OVP_BLANK_EN = 0x1 で設定される、構成可能なブランキング時間があります。OVP_BLANK_EN = 0x1 の場合、OVP 検出の堅牢性を向上させるため、ピーク デューティ サイクル期間中にブランキングが提供されます。これは OVP_BLANK_SEL ビットで 1ms または 4ms に設定できます。図 6-28 に、ソフト整流の各区間における OVP 検出動作を示します。方形波整流では立ち上がり、立ち下がりの区間はなく、ブランキング時間が有効化されている場合、整流インスタントから適用されます。

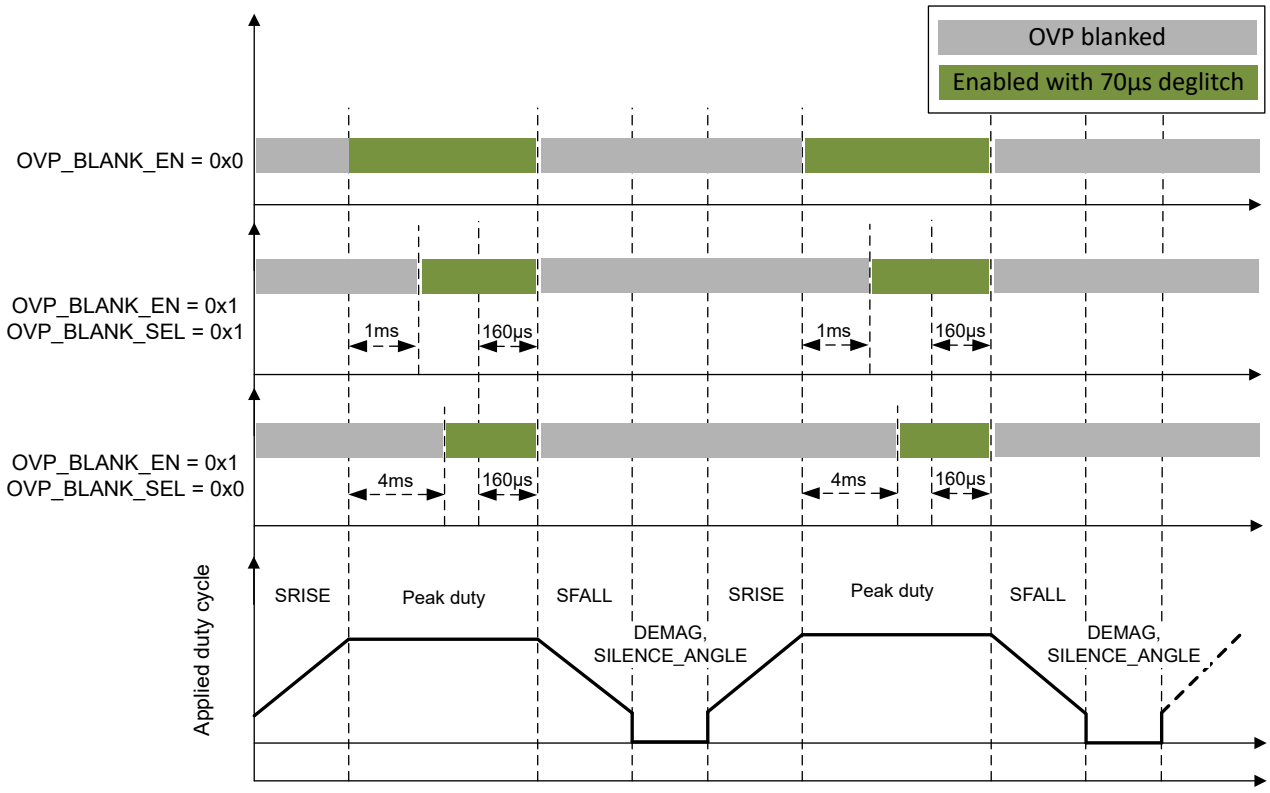


図 6-28. OVP 検出

6.3.2.6 サーマル シャットダウン (TSD)

MC121 は、ダイ温度が T_{TSD} を超えると動作するサーマル シャットダウン機能を備えています。サーマル シャットダウン中は、H ブリッジ内のすべての FET が無効になり、FG/RD ピンは表 6-4 の通り故障を通知します。ダイ温度が安全なレベル (T_{TSD} – T_{HYS}) まで低下すると、デバイスの動作は自動的に再開されます。

6.3.2.7 内蔵電源 (VM) クランプ

MC121 は、モーターからの回生エネルギーのプッシュバックによる VM ピンの電圧スパイクを制限するために、クランプ機能を内蔵しています。VM_CLAMP_DIS が 0x1 に設定されている場合、クランプは無効化されます。VM 電圧が VM_{CLAMP} の仕様に達すると、デバイスはクランプを有効にして VM ピンの電圧を制限します。クランプがアクティブの場合、HS FET はハイ インピーダンス状態になり、モーター駆動を停止します。クランプ回路は、安全動作領域 (SOA) で規定された制限値に達するまで、エネルギーを吸収することができます。SOA の制限値を超えると、クランプは非アクティブになります。より高いエネルギー (SOA の規定値を超える値) をクランプする必要がある場合、適切な外部 TVS ダイオードを追加する必要があります。

注

クランプ動作中に過熱 (TSD) 異常が発生した場合、TSD 異常がクリアされるまでクランプは非アクティブになります。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

6.4 デバイスの機能モード

6.4.1 アクティブ モード

V_{VM} 電圧が V_{UVLO} 電圧より大きく、D_{IN} が 0% を超えると、デバイスはアクティブ モードに移行します。t_{WAKE} 時間が経過すると、デバイスは入力に応答可能になります。

6.4.2 スリープ モードとスタンバイ モード

MC121 には低消費電力のスリープ モードがあり、SLEEP_EN = 0x1 に設定することで有効化できます。スリープ モード (SLEEP_EN = 0x1 および DIN = 0%) では、デバイスは VM ピンから非常に低い静止電流 (I_{VMQ}) を引き込みます。これは、FET、ホール センサ、電流センス、デジタル コア、内部レギュレータ、チャージ ポンプを含む内部回路を無効にすることで行われます。PWM 入力モード (PWMDC_MODE = 0x0) で DIN が t_{WAKE} の間、0% を超えると、デバイスはウェーク アップし、アクティブ (STBY_EN = 0x0) またはスタンバイ (STBY_EN = 0x1) モードに移行します。アナログ入力モード (PWMDC_MODE = 0x1) では、デバイスをスリープ状態からウェーク アップするには、PWM/DC ピンの電圧が t_{WAKE} の間、V_{IH} を超えている必要があります。

スリープ モードが無効 (SLEEP = 0x0) の場合、DIN < DIN0 の範囲におけるデバイスの動作は STBY_EN によって決まります。DIN < DIN0 かつ STBY_EN = 0x0 の場合、MC121 は DOUT0 に対応するデューティまたは速度でモーターを駆動します。DIN < DIN0 かつ STBY_EN = 0x1 の場合、MC121 はモーターの動作を停止 (DOUT = 0%) し、スタンバイ状態になります。

SLEEP_EN と STBY_EN の値に関係なく、DIN_OFF > DIN ≥ (DIN0 + DIN_HYS)の場合、MC121 はデューティ曲線で設定されたデューティまたは速度でモーターを駆動します。表 6-5 に、スリープおよびスタンバイ モードでの MC121 の動作をまとめています。

注

DIN = 0% は、PWM 入力モード (PWMDC_MODE = 0x0) ではデューティ サイクル 0% に対応し、DC (アナログ) 入力モード (PWMDC_MODE = 0x1) では DC 電圧 < $V_{DC_0\%}$ に対応します。

表 6-5. スリープ / スタンバイ モードの動作の概要

SLEEP_EN	STBY_EN	デバイス ステータス変更の条件	デバイス ステータス	DOUT	H ブリッジの状態
0x0	0x0	DIN < DIN0	アクティブ モード	DOUT0	PWM
	0x1		スタンバイ モード	0%	ハイ インピーダンス
X	X	DIN_OFF > DIN ≥ (DIN0 + DIN_HYS)	アクティブ モード	デューティ曲線に従って DIN で設定	PWM
0x1	X	DIN = 0%、図 6-8 を参照	スリープ モード	0%	ハイ インピーダンス
0x1	0x0	0% < DIN < DIN0	アクティブ モード	DOUT0	PWM
	0x1		スタンバイ モード	0%	ハイ インピーダンス

6.4.3 フォルト モード

MC121 は、セクション 6.3.2 に記載されているシステム異常から保護されています。場合によっては、整流アルゴリズムが中断され、デバイスがモーターを再起動する必要があります。

6.4.4 テスト モードとワンタイム プログラマブル メモリ

MC121 はテスト プログラミング モードを備えており、PWM/DC ピンと FG/RD ピンがデバイス構成とテストのための I^2C インターフェイスに対応しています。I^2C インターフェイスにより、OTP プログラミング モードで、ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリへのアクセスも可能になります。図 6-29 に、MC121 の構成とプログラミングのための基本的なハードウェア構成を示します。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

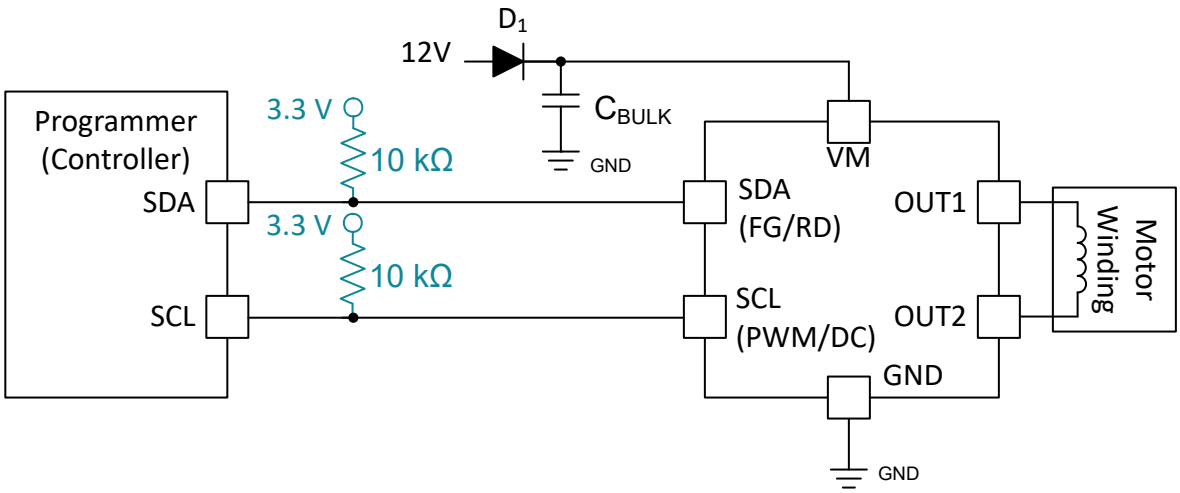


図 6-29. I²C プログラマおよびファン モジュール

MC121 は、以下の手順でテスト プログラミング モードおよび OTP プログラミング モードに移行します。

1. FG/RD ピンを Low にし、(20 ～ 80)% の範囲の任意のデューティで (416 ～ 833) kHz の範囲の高周波信号を 16 ～ 20 サイクルにわたって PWM/DC ピンに印加して、テスト プログラミング モードに入ります。I²C インターフェイスは、テスト プログラミング モードでアクティブです。
2. I²C 経由で MC121 と通信し、セクション 7 のレジスタの読み取りと書き込みを行い、レジスタを構成して目的の設定にします。
3. I²C 通信による信頼性の高い OTP メモリ プログラミングを維持するため、通信時間全体にわたって MC121 の電源ピン電圧 (VM) を 8V 以上に維持してください。
4. OTP プログラミング モードのロックを解除するには、連続した書き込みフレームで、OTP プログラミング モードのエントリ キー 02h、01h、04h を USR_OTP_PRG_UNLOCK レジスタに書き込みます。
5. OTP メモリを永続的にプログラムするには、USR_OTP_CFG レジスタの USR_OTP_PROG_ALL ビットに 1b を書き込みます。

6.5 プログラミング

MC121 は、テスト プログラミング モードと OTP プログラミング用の I²C プログラミングをサポートしています。セクション 6.4.4 で、システムのプロトタイプ製作時や生産時にテスト モードに移行し、レジスタの読み取りと書き込みを行い、OTP プログラミング モードに入り、OTP メモリをプログラムする方法を説明しています。外部プログラミング ハードウェアまたはオンボードのマイコンは、I²C インターフェイス経由で MC121 と接続できます。以下のセクションでは、I²C 通信プロトコルの詳細について説明します。

6.5.1 I²C 通信

I²C バスはデータ ライン (SDA) とクロック ライン (SCL) で構成され、オフ チップ プルアップ抵抗を備えています。バスがアイドルのときは、SDA ラインと SCL ラインの両方が High にプルされます。

通常はマイクロコントローラまたはデジタル信号プロセッサである制御装置がバスを制御します。制御装置は、SCL 信号とデバイス アドレスを生成する役割を担っています。コントローラは、データ転送の開始と停止を示す特定の条件も生成します。ペリフェラル デバイスは、コントローラ デバイスの制御下でバス上のデータを受信したり送信したりします。MC121 は、この文脈において I²C バス上のペリフェラル デバイスです。

MC121 のデバイス アドレスは 0x65 です。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

6.5.1.1 I²C 読み出し

I²C 読み出し動作は、書き込み動作と同様に開始されます。コントローラ デバイスは、ペリフェラル デバイスの 7 ビット アドレスと R/W ビットを 0b に設定して、バス上に START 条件を送信します。ペリフェラル デバイスがアクノリッジ信号 (ACK) で応答した後、コントローラ デバイスは読み出し対象のレジスタの 8 ビット アドレスを送信します。ペリフェラル デバイスが再び ACK で応答すると、コントローラ デバイスは START コマンド「RSTRT」を再送し、続いて R/W ビットを 1b としたペリフェラル アドレスを送信して読み出し動作であることを示します。コントローラ デバイスは SDA ラインを解放して、ペリフェラル デバイスからレジスタ データを読み出します。ペリフェラル デバイスは ACK 信号で応答し、レジスタ データの送信準備ができたことを示します。

コントローラ デバイスは、引き続きペリフェラル デバイスにクロック信号を供給します。ペリフェラル デバイスは、各クロック サイクルで SDA ラインに 8 ビットのレジスタ データを送信します。バイトの終わりに、コントローラ デバイスはネガティブ アクノリッジ (NACK) 信号を送信し、ペリフェラル デバイスに通信停止とバス解放を指示します。続いて、コントローラ デバイスは STOP 条件を送信します。

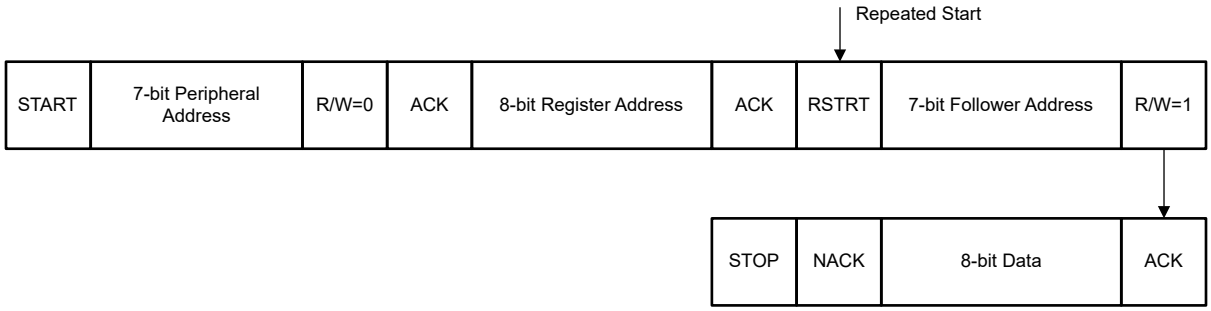


図 6-30. I²C 読み出しシーケンス

6.5.1.2 I²C 書き込み

I²C バスに書き込むとき、コントローラ デバイスは、ペリフェラル デバイスの 7 ビット アドレスで START 条件をバスに送信し、R/W ビットを 0b に設定して、書き込み動作にあることを示します。ペリフェラル デバイスがアクノリッジ ビット (ACK) で応答した後、コントローラ デバイスはデータを受信するレジスタの 8 ビット アドレスを送信します。ペリフェラル デバイスが ACK ビットで再度応答した後、コントローラ デバイスは 8 ビット データを送信します。ペリフェラル デバイスは最後の ACK ビットで応答し、コントローラは STOP 条件で転送を終了します。



図 6-31. I²C 書き込みシーケンス

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7 レジスタ マップ

表 7-1 に、テスト プログラミング モードと OTP プログラミング モードで MC121 を設定するためのレジスタ マップを示します。USER_OTP マップ (アドレス 0x00 ～ 0x1B) には、プロトタイピングおよびエンド システム製造時のプログラミングで使用できる OTP レジスタが含まれています。USR_TM レジスタ マップ (アドレス 0x20 ～ 0x26) には、システム設計者がシステムのプロトタイピングや開発中に異常や速度を読み出したり、速度入力などのデバイス設定を行ったりするための設定項目が含まれています。書き込み済み OTP レジスタは、パワー サイクル後も書き込まれたデータを保持します。OTP 書き込み後、レジスタはテスト モードで新しいデータを受信できますが、デバイスのパワー サイクル時には、書き込まれた OTP 値がデフォルトとして使用されます。テスト モード レジスタ USR_TM は OTP メモリ レジスタではなく、パワー サイクル時にリセットされます。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1 USR_OTP レジスタ

表 7-1 に、USR_OTP レジスタのメモリ マップト レジスタを示します。表 7-1 にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。

表 7-1. USR_OTP レジスタ

オフセット	略称	レジスタ名	セクション
0h	INTERFACE_CONFIG0	インターフェイス構成レジスタ 0	セクション 7.1.1
1h	INTERFACE_CONFIG1	インターフェイス構成レジスタ 1	セクション 7.1.2
2h	START_STOP_CONFIG	開始および停止構成レジスタ	セクション 7.1.3
3h	DIN0	DIN0 の設定	セクション 7.1.4
4h	DOUT0	DOUT0 の設定	セクション 7.1.5
5h	DOUT1	DOUT1 の設定	セクション 7.1.6
6h	DOUT2	DOUT2 の設定	セクション 7.1.7
7h	DOUT3	DOUT3 の設定	セクション 7.1.8
8h	DOUT4	DOUT4 の設定	セクション 7.1.9
9h	DOUT5	DOUT5 の設定	セクション 7.1.10
Ah	DOUT6	DOUT6 の設定	セクション 7.1.11
Bh	DOUT7	DOUT7 の設定	セクション 7.1.12
Ch	DOUT8	DOUT8 の設定	セクション 7.1.13
Dh	HALL_TIME_CONFIG	ホール オフセット時間の構成レジスタ	セクション 7.1.14
Eh	COMMUTATION_CONFIG0	整流構成レジスタ 0	セクション 7.1.15
Fh	COMMUTATION_CONFIG1	整流構成レジスタ 1	セクション 7.1.16
10h	COMMUTATION_CONFIG2	整流構成レジスタ 2	セクション 7.1.17
11h	COMMUTATION_CONFIG3	整流構成レジスタ 3	セクション 7.1.18
12h	PROTECTION_CONFIG	保護設定の構成レジスタ	セクション 7.1.19
13h	CLOSED_LOOP_CONFIG0	MAX_SPEED の最下位バイト	セクション 7.1.20
14h	CLOSED_LOOP_CONFIG1	閉ループでの MAX_SPEED の KI_RATIO と MSN、および開ループでの DOUT_MAX	セクション 7.1.21
15h	CLOSED_LOOP_CONFIG2	閉ループでの KP_RATIO と LRD 設定	セクション 7.1.22
16h	GENERAL_CONFIG0	保護および PWM ディザリング用レジスタ	セクション 7.1.23
17h	GENERAL_CONFIG1	ILIM_SEL、ホール、LRD 設定用レジスタ	セクション 7.1.24
18h	GENERAL_CONFIG2	VM クランプ、プリスタート ランプ、ホール設定用レジスタ	セクション 7.1.25
19h	GENERAL_CONFIG3	サイレンス、極ペア、LRD 設定用レジスタ	セクション 7.1.26
1Ah	GENERAL_CONFIG4	DEMAG およびサイレンス設定用構成レジスタ	セクション 7.1.27
1Bh	USR_OTP_CRC	USR_OTP に対して計算された CRC 用レジスタ	セクション 7.1.28

表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 7-2 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。

表 7-2. USR_OTP アクセス タイプ コード

アクセス タイプ	コード	説明
読み取りタイプ		
R	R	読み出し
書き込みタイプ		
W	W	書き込み
リセットまたはデフォルト値		

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

表 7-2. USR_OTP アクセス タイプ コード (続き)

アクセス タイプ	コード	説明
-n		リセット後の値またはデフォルト値

7.1.1 INTERFACE_CONFIG0 レジスタ (オフセット = 0h) [リセット = 00h]

INTERFACE_CONFIG0 を表 7-3 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-3. INTERFACE_CONFIG0 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7	HALL_DEGLITCH_SEL	R/W	0h	ホール センサのホール信号のグリッチ除去を有効化します 0h = ホールのグリッチ除去時間 1µs 1h = ホールのグリッチ除去時間 2µs
6	PWM_IN_RANGE	R/W	0h	入力 PWM 信号の周波数検出範囲を選択します 0h = 80Hz～90kHz 1h = 20Hz～22kHz
5	PWM_OUT_FREQ	R/W	0h	OUTx の PWM スイッチング周波数を選択します 0h = 出力 PWM 周波数 25kHz 1h = 出力 PWM 周波数 50kHz
4-3	ILIM_BLANK_SEL	R/W	0h	デッドタイムとデフォルトのブランキングに加えて、電流制限 (ILIMIT) の追加のブランキング時間を選択します 0h = 追加のブランキングなし 1h = 追加のブランキング時間 160ns 2h = 追加のブランキング時間 320ns 3h = 追加のブランキング時間 640ns
2	ILIM_DEGLITCH_SEL	R/W	0h	サイクル単位の電流制限 (ILIMIT) のグリッチ除去時間を選択します。 0h = グリッチ除去時間 600ns 1h = グリッチ除去時間 1.2µs
1-0	UVLO_SEL	R/W	0h	低電圧誤動作防止がトリガされるスレッショルドを選択します 0h = 立ち上がりスレッショルド 3V、立ち下がりスレッショルド 2.7V 1h = 立ち上がりスレッショルド 4.2V、立ち下がりスレッショルド 2.7V 2h = 立ち上がりスレッショルド 5.7V、立ち下がりスレッショルド 2.7V 3h = 立ち上がりスレッショルド 7.6V、立ち下がりスレッショルド 2.7V

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.2 INTERFACE_CONFIG1 レジスタ (オフセット = 1h) [リセット = 60h]

INTERFACE_CONFIG1 を表 7-4 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-4. INTERFACE_CONFIG1 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-6	DIN_HYS	R/W	1h	速度曲線にデューティ サイクル ヒステリシス DIN_HYS を選択します。 0h = 0%、ヒステリシスなし 1h = 1.2% 2h = 2.4% 3h = 4.8%
5	STBY_EN	R/W	1h	スタンバイ モードを有効または無効にします。DIN = 0% 時の OUTx の動作は、スタンバイ モードによって決まります。 0h = ドライバは DOUT0 デューティ サイクルでモーターを整流。 1h = ドライバは t_{SLEEP} 後に出力を無効化しますが、すべての内部回路はアクティブを維持し、より高速に再有効化します。
4	SLEEP_EN	R/W	0h	DIN = 0% のとき、スリープ モードを有効化します。 0h = スリープ モードは無効化。ドライバの状態は STBY_EN ビットによって決まります。 1h = スリープ モードを有効化。DOUT は 0% の出力デューティ サイクルまで下降し、t_{SLEEP} の間ホール エッジが受信されないと、ドライバは低消費電力スリープ モードへ移行します。
3	PWMDC_MODE	R/W	0h	速度入力モードとして、PWM またはアナログのいずれかを選択します。 0h = PWM ピンは、速度を制御するためにロジック PWM のデューティ サイクルを受け入れます。 1h = PWM ピンは、モーター速度を制御するためにアナログ電圧を受け入れます。
2	FGRD_INVERT	R/W	0h	回転子ロック時またはデバイス故障時に、FG/RD ピンのロジック レベルを選択します。 0h = 回転子ロックまたはデバイス故障中、FG/RD ピンは Low にアサートされます。 1h = 回転子ロックまたはデバイス故障中、FG/RD ピンは High にアサートされます。
1	FGRD_MODE	R/W	0h	FG/RD ピンの機能を選択します。 0h = FG 速度フィードバック出力 1h = RD 回転子ロック検出または故障出力
0	FGRD_FAULT_SEL	R/W	0h	FG/RD ピンがデバイス異常を通知するかどうかを選択します。 0h = FG/RD ピンは回転子ロック故障のみを通知 1h = FG/RD ピンは、回転子ロック、過電圧、過電流、サーマル シャットダウン、低電圧の各異常状態を通知

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.3 START_STOP_CONFIG レジスタ (オフセット = 2h) [リセット = 89h]

START_STOP_CONFIG を 表 7-5 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-5. START_STOP_CONFIG レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7	RAMP_ON_STOP_DIS	R/W	1h	停止時にデューティ サイクルをゼロまでランプ ダウンするか、停止コマンド時に直ちにゼロ デューティ サイクルを適用するかを選択します 0h = PWM_RAMP_EN、PWM_RAMP_SEL、および PWM_DECEL_SEL ビットに基づいて、デューティ サイクルを 0 までランプ ダウンします 1h = モーター停止コマンドを受信すると、FET を即座にハイ インピーダンスにする
6-5	DIN_OFF	R/W	0h	出力デューティ サイクルがゼロとなる、入力デューティ サイクルのスレッショルドを選択します 0h = 無効。DOUT が 0 となる、入力デューティ サイクルの値は設定されません 1h = 入力デューティ サイクルが 90% 以上の場合、DOUT は 0% となります 2h = 入力デューティ サイクルが 95% 以上の場合、DOUT は 0% となります 3h = 入力デューティ サイクルが 100% の場合、DOUT は 0% となります
4-2	DOUT_MIN	R/W	2h	入力デューティ サイクルが DIN0 と DINOFF の間にある場合、DOUT がクランプされる最小値を選択します 0h = 0% 1h = 5% 2h = 10% 3h = 12.5% 4h = 15% 5h = 20% 6h = 25% 7h = 30%
1-0	DOUT_START	R/W	1h	モーター起動時に適用される DOUT を選択します。DOUT は、この初期値から目標デューティ サイクルまでランプ アップします。 0h = 開ループで DOUT_MAX の 12.5%、閉ループで 12.5% 1h = 開ループで DOUT_MAX の 25%、閉ループで 25% 2h = 開ループで DOUT_MAX の 50%、閉ループで 50% 3h = 開ループで DOUT_MAX の 100%、閉ループで 100%

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.4 DIN0 レジスタ (オフセット = 3h) [リセット = 16h]

DIN0 を表 7-6 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-6. DIN0 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	DIN0	R/W	16h	速度曲線が受け入れる最小入力デューティ サイクル DIN を設定します。 DIN = 100% × DIN0/255 0h = 0% 1h = 0.39126% 16h = 8.8% (デフォルト) FFh = 100%

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.5 DOUT0 レジスタ (オフセット = 4h) [リセット = 1Ah]

DOUT0 を表 7-7 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-7. DOUT0 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	DOUT0	R/W	1Ah	DIN ≤ DIN0 のときの出力デューティ DOUT を設定します DOUT = 100% x DOUT0/255 0h = 0%、すべての FET がオフになり、ドライバはハイ インピーダンス状態になる 1h = 0.39126% 1Ah = 10.2% (デフォルト) FFh = 100%

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.6 DOUT1 レジスタ (オフセット = 5h) [リセット = 20h]

DOUT1 を表 7-8 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-8. DOUT1 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	DOUT1	R/W	20h	DIN = 12.5% のときの出力デューティ DOUT を設定します DOUT = 100% x DOUT1/255 0h = 0%、両方の出力が Low に維持され、ドライバはブレーキ状態になる 20h = 12.5% (デフォルト) FFh = 100%

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.7 DOUT2 レジスタ (オフセット = 6h) [リセット = 40h]

DOUT2 を表 7-9 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-9. DOUT2 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	DOUT2	R/W	40h	DIN = 25% のときの出力デューティ DOUT を設定します DOUT = 100% x DOUT1/255 0h = 0%、両方の出力が Low に維持され、ドライバはブレーキ状態になる 40h = 25% (デフォルト) FFh = 100%

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.8 DOUT3 レジスタ (オフセット = 7h) [リセット = 60h]

DOUT3 を表 7-10 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-10. DOUT3 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	DOUT3	R/W	60h	DIN = 37.5% のときの出力デューティ DOUT を設定します DOUT = 100% x DOUT1/255 0h = 0%、両方の出力が Low に維持され、ドライバはブレーキ状態になる 60h = 37.5% (デフォルト) FFh = 100%

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.9 DOUT4 レジスタ (オフセット = 8h) [リセット = 80h]

DOUT4 を表 7-11 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-11. DOUT4 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	DOUT4	R/W	80h	DIN = 50% のときの出力デューティ DOUT を設定します DOUT = 100% x DOUT1/255 0h = 0%、両方の出力が Low に維持され、ドライバはブレーキ状態になる 80h = 50% (デフォルト) FFh = 100%

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.10 DOUT5 レジスタ (オフセット = 9h) [リセット = A0h]

DOUT5 を表 7-12 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-12. DOUT5 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	DOUT5	R/W	A0h	DIN = 62.5% のときの出力デューティ DOUT を設定します DOUT = 100% x DOUT1/255 0h = 0%、両方の出力が Low に維持され、ドライバはブレーキ状態になる A0h = 62.5% (デフォルト) FFh = 100%

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.11 DOUT6 レジスタ (オフセット = Ah) [リセット = C0h]

DOUT6 を表 7-13 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-13. DOUT6 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	DOUT6	R/W	C0h	DIN = 75% のときの出力デューティ DOUT を設定します DOUT = 100% x DOUT1/255 0h = 0%、両方の出力が Low に維持され、ドライバはブレーキ状態になる C0h = 75% (デフォルト) FFh = 100%

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.12 DOUT7 レジスタ (オフセット= Bh) [リセット= E0h]

DOUT7 を表 7-14 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-14. DOUT7 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	DOUT7	R/W	E0h	DIN = 87.5% のときの出力デューティ DOUT を設定します DOUT = 100% x DOUT1/255 0h = 0%、両方の出力が Low に維持され、ドライバはブレーキ状態になる E0h = 87.5% (デフォルト) FFh = 100%

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.13 DOUT8 レジスタ (オフセット = Ch) [リセット = FFh]

DOUT8 を表 7-15 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-15. DOUT8 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	DOUT8	R/W	FFh	DIN = 100% のときの出力デューティ DOUT を設定します DOUT = 100% x DOUT1/255 0h = 0%、両方の出力が Low に維持され、ドライバはブレーキ状態になる FFh = 100% (デフォルト)

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.14 HALL_TIME_CONFIG レジスタ (オフセット = Dh) [リセット = 00h]

HALL_TIME_CONFIG を 表 7-16 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-16. HALL_TIME_CONFIG レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	HALL_OS_TIME	R/W	0h	ホール リード/ラグ時間オフセット。 t_{HALL_OS} = HALL_OS_TIME*10.24µs 00h = 0 01h = 10.24µs 02h = 20.48µs FFh = 2.6ms

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.15 COMMUTATION_CONFIG0 レジスタ (オフセット = Eh) [リセット = 00h]

COMMUTATION_CONFIG0 を表 7-17 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-17. COMMUTATION_CONFIG0 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-6	FG_MULTIPLIER	R/W	0h	この係数は FG 出力周波数に乗算され、モーターの極数が変化しても速度フィードバック周波数を同じに維持します。 0h = 1/2x 1h = 2/3x 2h = 1x 3h = 2x
5	FG_HALL_RAW_EN	R/W	0h	FG/RD ピンを駆動するホール センサからの未加工ホール信号を有効化します。 0h = FG_MULTIPLIER 係数に基づいたホール オフセット信号が FG/RD ピンを駆動します 1h = ホール ラッチ センサの出力が FG/RD ピンを駆動します。FG_MULTIPLIER 係数はホール信号に適用されません。
4-3	COMMUTATION_MODE	R/W	0h	出力 PWM 波形の整流モードを選択します。 0h = 方形波整流 1h = ソフト整流
2-0	PWM_MODE	R/W	0h	PWM、電流制限、および消磁のオフ時間中の出力動作を選択します 0h = PWM、電流制限、および消磁のハイブリッドモード 1h = PWM および電流制限のハイブリッドモード、消磁の非同期モード 2h = PWM および電流制限の非同期モード、消磁のハイブリッドモード 3h = PWM および電流制限の同期モード、消磁のハイブリッドモード 4h = PWM、電流制限、および消磁の同期モード 5h = PWM および電流制限の同期モード、消磁の非同期モード 6h = PWM および電流制限の非同期モード、消磁の同期モード 7h = PWM、電流制限、消磁のための非同期モード

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.16 COMMUTATION_CONFIG1 レジスタ (オフセット= Fh) [リセット= A0h]

COMMUTATION_CONFIG1 を表 7-18 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-18. COMMUTATION_CONFIG1 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7	PWM_RAMP_EN	R/W	1h	PWM ランプ機能を有効または無効にします 0h = PWM ランプ機能が無効で、入力デューティ サイクルを DOUT に即座に適用する 1h = PWM ランプ機能が有効で、PWM_RAMP_SEL ビットに応じてランプ レートを設定する
6-5	PWM_RAMP_SEL	R/W	1h	モーターの起動から DOUT が 0 から 100% にランプ アップするまでの総時間。本設定は速度入力が変化したときのランプ レートも制御します。 0h = 10.7s (デューティ サイクル ランプ レート 9.35%/s) 1h = 5.35s (デューティ サイクル ランプ レート 18.70%/s) 2h = 2.67s (デューティ サイクル ランプ レート 37.40%/s) 3h = 1.34s (デューティ サイクル ランプ レート 74.8%/s)
4-0	SRISE	R/W	0h	ソフト整流の立ち上がりランプを設定します。方形波整流のデフォルトは 0 度。 θ_{SRISE} = (SRISE*2.8 度) + 2.8 度 00h = 2.8° 01h = 5.6° 1Fh = 90°

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.17 COMMUTATION_CONFIG2 レジスタ (オフセット = 10h) [リセット = 20h]

COMMUTATION_CONFIG2 を表 7-19 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-19. COMMUTATION_CONFIG2 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-6	予約済み	R/W	0h	予約済み
5	PWM_DECEL_SEL	R/W	1h	減速時のランプ レートが PWM_RAMP_SEL 設定と同じか、その半分かを選択します 0h = 減速デューティ サイクル ランプ レートを PWM_RAMP_SEL で設定します 1h = 減速 デューティ サイクル ランプ レートは PWM_RAMP_SEL の半分となります
4-0	SFALL	R/W	0h	ソフト整流の立ち下がりランプを設定します。方形波整流のデフォルトは 0 度。 θ_{SFALL} = (SFALL × 2.8 度) + 2.8 度 00h = 2.8° 01h = 5.6° 1Fh = 90°

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.18 COMMUTATION_CONFIG3 レジスタ (オフセット = 11h) [リセット = 46h]

COMMUTATION_CONFIG3 を表 7-20 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-20. COMMUTATION_CONFIG3 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-6	AUTO_DEMAG_EN	R/W	1h	PRESTART 後の自動消磁時間を有効または無効にします 0h = t_{DEMAG} を DEMAG ビットに従って設定 1h = 電流のゼロ交差を検出し、t_{DEMAG} 時間の持続時間を自動的に決定 2h = 予約済み 3h = 予約済み
5-4	AUTO_DEMAG_STEP	R/W	0h	自動消磁が有効化されている場合の消磁時間のステップ分解能 0h = 2.56µs 1h = 5.12µs 2h = 10.24µs 3h = 20.48µs
3	予約済み	R/W	0h	予約済み
2-1	HALL_REGEN_EN	R/W	3h	整流用のホール再生成を有効または無効にします 0h=ディセーブル 1h = 予約済み 2h = 予約済み 3h = イネーブル
0	予約済み	R/W	0h	予約済み

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.19 PROTECTION_CONFIG レジスタ (オフセット = 12h) [リセット = 04h]

PROTECTION_CONFIG を表 7-21 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-21. PROTECTION_CONFIG レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7	SPEED_LOOP_EN	R/W	0h	閉ループ速度制御動作を有効化または無効化します 0h = 入力コマンドを目標デューティ サイクルとする開ループ動作 1h = 入力コマンドを目標速度とする閉ループ動作
6	OVP_EN	R/W	0h	過電圧保護を有効化または無効化 0h = 過電圧保護を無効化 1h = 過電圧保護を有効化
5-4	OVP_SEL	R/W	0h	過電圧保護スレッショルドを選択します 0h = 34.5V 立ち上がり、33.1V 立ち下がり 1h = 22.6V 立ち上がり、21.1V 立ち下がり 2h = 18.1V 立ち上がり、16.6V 立ち下がり 3h = OVP なし
3	OCP_RETRY_MODE	R/W	0h	OCP の後に無制限に再試行するか、3 回連続の再試行後に停止するかを制御します 0h = 無制限に再試行 1h = 連続して 3 回のみ再試行
2-0	LRD_LONG_RETRY_SEL	R/W	4h	t_{LRD_START} から $t_{lock_long_retry}$ を計算する乗数を選択します 0h = x 2 1h = x 4 2h = x 8 3h = x 10 4h = x 12 5h = x 16 6h = x 24 7h = x 28

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.20 CLOSED_LOOP_CONFIG0 レジスタ (オフセット = 13h) [リセット = 00h]

CLOSED_LOOP_CONFIG0 を表 7-22 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-22. CLOSED_LOOP_CONFIG0 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	MAX_SPEED_LSB	R/W	0h	閉ループで 100% デューティ サイクルで動作している場合に、デバイスが目標とする Hz 単位の電気的最大速度 (fMax) を表す 12 ビット値の 8LSB を設定します。目標電気的速度 (Hz) = DOUT * MAX_SPEED

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.21 CLOSED_LOOP_CONFIG1 レジスタ (オフセット = 14h) [リセット = FFh]

CLOSED_LOOP_CONFIG1 を表 7-23 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-23. CLOSED_LOOP_CONFIG1 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-4	DOUT_MAX_MSN または KI_RATIO	R/W	Fh	開ループ:DIN が DIN0 と DINOFF の間にある場合、DOUT がクランプされる最大値である DOUT_MAX の最上位ニブル (MSN) を設定します。DOUT_MAX には、25% の最小クランプ値クランプが設けられています。 閉ループ:速度コントローラの積分項 (Ki) を設定します。 0h = Kp x 8 1h = Kp x 4 2h = Kp x 2 3h = Kp x 1 4h = Kp/2 5h = Kp/4 6h = Kp/8 7h = Kp/16
3-0	DOUT_MAX_LSN または MAX_SPEED_MSN	R/W	Fh	開ループ:DIN が DIN0 と DINOFF の間にある場合、DOUT がクランプされる最大値である DOUT_MAX の最下上位ニブル (LSN) を設定します。DOUT_MAX には、25% の最小クランプ値クランプが設けられています。 閉ループ:閉ループで 100% デューティ サイクルで動作している場合に、デバイスが目標とする Hz 単位の電気的最大速度 (fMax) を表す 12 ビット値の 4 MSN (最上位ニブル) を設定します。目標電気的速度 (Hz) = DOUT * MAX_SPEED

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.22 CLOSED_LOOP_CONFIG2 レジスタ (オフセット = 15h) [リセット = 02h]

CLOSED_LOOP_CONFIG2 を表 7-24 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-24. CLOSED_LOOP_CONFIG2 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-6	LRD_NRETRY_STARTUP	R/W	0h	リセット、スリープ、スタンバイからウェークアップした後の起動時、回転子ロックが検出されたときにロング リトライ期間が適用されるまでのリトライ回数。 0h = リトライなし 1h = リトライ 1 回 2h = リトライ 2 回 3h = リトライ 3 回
5-4	LRD_NRETRY_RUN	R/W	0h	モーター動作中に、回転子ロックが検出されたときにロング リトライ期間が適用されるまでのリトライ回数。 0h = リトライなし 1h = リトライ 1 回 2h = リトライ 2 回 3h = リトライ 3 回
3	DEADTIME_SEL	R/W	0h	フル ブリッジのデッドタイム期間を選択します 0h = デッドタイムは 600ns 1h = デッドタイムは 520ns
2-0	KP_RATIO	R/W	2h	閉ループ速度制御における、電気的最大周波数 (fMax) に対する速度コントローラの比例ゲイン (Kp)。 0h = 8/fMax 1h = 4/fMax 2h = 2/fMax 3h = 1/fMax 4h = 1/(2*fMax) 5h = 1/(4*fMax) 6h = 1/(8*fMax) 7h = 1/(16*fMax)

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.23 GENERAL_CONFIG0 レジスタ (オフセット = 16h) [リセット = 44h]

GENERAL_CONFIG0 を表 7-25 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-25. GENERAL_CONFIG0 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7	OVP_BLANK_SEL	R/W	0h	ピーク デューティ サイクル フェーズ中に適用されるブランキング期間を選択します。 0h = ピーク デューティ サイクル中の 4ms 間、ブランキングがアクティブ 1h = ピーク デューティ サイクル開始 1ms 後にブランキングがアクティブ
6	OVP_BLANK_EN	R/W	1h	ピーク デューティ サイクル フェーズにおける OVP ブランキング時間を有効化または無効化します 0h = SRISE および SFALL フェーズに加えて、OVP_BLANK_SEL に従って、ピーク デューティ サイクル フェーズの OVP ブランキング 1h = ピーク デューティ サイクル フェーズで OVP ブランキングはなく、ブランキングは SRISE フェーズと SFALL フェーズでのみアクティブ
5	OCP_DEGLITCH_SEL	R/W	0h	OCP のグリッチ除去時間を選択します 0h = OCP グリッチ除去時間は 200ns 1h = OCP グリッチ除去時間は 500ns
4	ADJUST_DITHER_FOR_OSC_EN	R/W	0h	各ディザ ステップで発生する発振器の周波数変動を考慮して、ディザ ステップ期間を調整します。ディザリングは PWM 周期に関するものであるため、この調整によってステップあたりの実時間を均等化します。 DITHER_DWELL_SEL が 2h または 3h に設定され、 ADAPTIVE_DWELL_EN が 0 の場合のみ適用されます。 0h = 発振器の周波数変動に対するディザ調整を無効化 1h = 発振器の周波数変動に対するディザ調整を有効化
3-2	DITHER_DWELL_SEL	R/W	1h	ディザ周波数のステップあたりの保持時間を制御します 0h = 1 PWM 周期 1h = 4 PWM 周期 2h = 16 PWM 周期 3h = 64 PWM 周期
1	ADAPTIVE_DWELL_EN	R/W	0h	DITHER_EN が 1h の場合に適用される、ディザリングの速度ベースの保持時間を有効化します 0h = 適応型保持時間は無効 1h = 適応型保持時間は有効
0	DITHER_EN	R/W	0h	内部発振器のディザリングが有効化され、それに伴い PWM 出力もディザリングされます 0h = ディザリングは無効 1h = ディザリングは有効

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.24 GENERAL_CONFIG1 レジスタ (オフセット = 17h) [リセット = 46h]

GENERAL_CONFIG1 を表 7-26 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-26. GENERAL_CONFIG1 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7	HALL_INVERT	R/W	0h	このビットはホール オフセット信号を整流ブロックに対して反転します。 0h = 非反転ホール ラッチ信号 1h = 反転ホール ラッチ信号
6	HALL_TIME_MODE	R/W	1h	ホール オフセットの時間成分を進み先行方向または遅れ方向に適用するかを選択します 0h = ホール オフセット信号はホール ラッチ出力信号より t_{HALL_OS} だけ遅れる 1h = ホール オフセット信号はホール ラッチ出力信号より t_{HALL_OS} 分だけ進む
5-4	LRD_TIME_STARTUP	R/W	0h	起動時の回転子ロック検出時間 t_{LRD_START} を選択します。ロング リトライ時間 $t_{lock_long_retry}$ の計算にも使用されます。 0h = 325ms 1h = 440ms Ah = 524ms Bh = 1.05s
3-0	ILIMIT_SEL	R/W	6h	電流制限スレッショルドを選択します。0h ～ 9h の値のみが有効です。 0h = 0.32A 1h = 0.43A 2h = 0.53A 3h = 0.63A 4h = 0.73A 5h = 0.83A 6h = 0.94A 7h = 1.03A 8h = 1.12A 9h = 1.21A

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.25 GENERAL_CONFIG2 レジスタ (オフセット = 18h) [リセット = 81h]

GENERAL_CONFIG2 を表 7-27 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-27. GENERAL_CONFIG2 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7	VM_CLAMP_DIS	R/W	1h	VM クランプ機能を有効または無効にします 0h = VM クランプ有効 1h = VM クランプ無効
6	HALL_ANGLE_MODE	R/W	0h	ホール オフセットの角度成分を先行方向または遅れ方向に適用するかを選択します 0h = ホール オフセット信号はホール ラッチ出力信号より $\theta_{HALL_OS_ANGLE}$ だけ遅れる 1h = ホール オフセット信号はホール ラッチ出力信号より $\theta_{HALL_OS_ANGLE}$ 分だけ進む
5-1	HALL_OS_ANGLE	R/W	0h	ホール オフセットの角度成分 (度) 0h = 0° 1h = 1.4° 1Fh = 43.6°
0	PRESSTART_RAMP_EN	R/W	1h	プリスタート PWM ランプ機能を有効または無効にします 0h = プリスタート ランプ機能は無効で、入力デューティ サイクルが DOUT に即座に適用される 1h = プリスタート ランプ機能は有効で、PWM_RAMP_SEL ビットに従ってランプ レートが設定される

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.26 GENERAL_CONFIG3 レジスタ (オフセット = 19h) [リセット = 24h]

GENERAL_CONFIG3 を表 7-28 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-28. GENERAL_CONFIG3 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-4	SILENCE_ANGLE	R/W	2h	整流開始時の PWM サイレンス角度 (電気角) を設定します 0h = 0.0° 1h = 1.4° 2h = 2.8° 3h = 4.2° 4h = 5.6° 5h = 7.0° 6h = 8.4° 7h = 9.8° 8h = 11.3° 9h = 12.7° 10h = 14.1° 11h = 15.5° 12h = 16.9° 13h = 18.3° 14h = 19.7° 15h = 21.1°
3-2	POLE_PAIR	R/W	1h	回転子の極ペア数を示します 0h = 1 極ペア 1h = 2 極ペア 2h = 3 極ペア 3h = 4 極ペア
1	LRD_RETRY_DIS	R/W	0h	回転子ロックが検出された際、5 回連続してリトライした後に、それ以上のリトライを無効化します 0h = リトライ回数無制限 1h = リトライ回数を 4 回に制限
0	PWRUP_PWMDC_MASK	R/W	0h	リセット状態からの初回パワーアップ時に、PWM/DC ピンの入力速度コマンドを 1 秒間マスクする機能を有効または無効にします 0h = PWM/DC ピン入力をマスクしない 1h = 初回パワーアップ時に PWM/DC ピン入力を 1 秒間マスクする

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.27 GENERAL_CONFIG4 レジスタ (オフセット = 1Ah) [リセット = 08h]

GENERAL_CONFIG4 を表 7-29 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-29. GENERAL_CONFIG4 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-1	DEMAG_TIME	R/W	4h	整流終了までの消磁時間を µs 単位で設定します 0h = 0µs 1h = 40.96µs 2h = 81.92µs 7Fh = 5.2ms
0	SILENCE_MODE	R/W	0h	サイレンス フェーズ中の出力 FET の状態を選択します 0h = サイレンス フェーズ中、すべての FET はハイ インピーダンスとなる 1h = サイレンス フェーズで非同期モードとなる

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.1.28 USR_OTP_CRC レジスタ (オフセット = 1Bh) [リセット = 00h]

USR_OTP_CRC を 表 7-30 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-30. USR_OTP_CRC レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	USR_OTP_CRC	R/W	0h	USR_OTP レジスタに対して計算された CRC 値

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.2 USR_TM レジスタ

表 7-31 に、USR_TM レジスタのメモリマップト レジスタを示します。表 7-31 にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。

表 7-31. USR_TM レジスタ

オフセット	略称	レジスタ名	セクション
20h	TEST_FAULT	故障をテストするためのレジスタ	セクション 7.2.1
21h	TEST_DIN	デューティ サイクル入力制御	セクション 7.2.2
22h	TEST_FAULT_STATUS	故障タイプを示すレジスタ	セクション 7.2.3
23h	TEST_SPEED_MSB	速度フィードバック	セクション 7.2.4
24h	TEST_SPEED	速度フィードバック	セクション 7.2.5
25h	USR_OTP_CFG	USR_OTP のプログラミングを設定するためのレジスタ	セクション 7.2.6
26h	USR_OTP_PRG_UNLOCK	USR_OTP をプログラムまたは検証するためのアクセスをロック解除	セクション 7.2.7

表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 7-32 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。

表 7-32. USR_TM アクセス タイプ コード

アクセス タイプ	コード	説明
読み取りタイプ		
R	R	読み出し
書き込みタイプ		
W	W	書き込み
W0C	W 0C	書き込み 0 でクリア
リセットまたはデフォルト値		
-n		リセット後の値またはデフォルト値

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.2.1 TEST_FAULT レジスタ (オフセット = 20h) [リセット = 00h]

TEST_FAULT を 表 7-33 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-33. TEST_FAULT レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7	フォルト	R	0h	このビットを読み出すと、デバイスが異常モード (OCP、OVP、UVLO、回転子ロック、TSD) になっていることを示します。電流制限動作は、このビットでは通知されません。 0h = アクティブ モード 1h = 故障モード
6-0	予約済み	R	0h	予約済み

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.2.2 TEST_DIN レジスタ (オフセット = 21h) [リセット = 01h]

TEST_DIN を 表 7-34 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-34. TEST_DIN レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	DIN_CNTRL	R/W	1h	このレジスタに書き込むと、I2C で PWM ピンが使用できない間、速度を制御するための入力デューティ サイクル DIN が設定されます。 DIN = DIN_CTRL/255 0h = 0% A0h = 62.5% FFh = 100%

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.2.3 TEST_FAULT_STATUS レジスタ (オフセット = 22h) [リセット = 00h]

TEST_FAULT_STATUS を 表 7-35 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-35. TEST_FAULT_STATUS レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-6	予約済み	R	0h	予約済み
5	予約済み	R/W0C	0h	予約済み
4	TSD	R/W0C	0h	このビットを読み出すと、デバイスが温度シャットダウン (TSD) 保護中であることを示します。 0h = 通常動作 1h = TSD 故障
3	UVLO	R	0h	このステータス ビットは、デバイスが低電圧 (UVLO) 状態であることを示します。 0h = 通常動作 1h = UVLO 故障
2	OVP	R/W0C	0h	このビットを読み出すと、デバイスが過電圧保護 (OVP) 状態であることを示します。 0h = 通常動作 1h = OVP 故障
1	LRP	R	0h	このビットを読み出すと、デバイスが回転子ロック保護 (LRP) 状態であることを示します。 0h = 通常動作 1h = LRP 故障
0	OCP	R/W0C	0h	このビットを読み出すと、デバイスが過電流保護状態であることを示します。 0h = 通常動作 1h = OCP 故障

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.2.4 TEST_SPEED_MSB レジスタ (オフセット = 23h) [リセット = 00h]

TEST_SPEED_MSB を 表 7-36 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-36. TEST_SPEED_MSB レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	ELECTRICAL_PERIOD_MSB	R	0h	このレジスタを読み出すと、モーターの電気的サイクルの周期が取得できます。FG ピンが使用できないテスト モード中の速度フィードバックに役立ちます。合計電気的周期は、10.24µs * ((ELECTRICAL_PERIOD_MSB << 8) + (ELECTRICAL_PERIOD)) の計算値の 2 倍になります

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.2.5 TEST_SPEED レジスタ (オフセット = 24h) [リセット = 00h]

TEST_SPEED を表 7-37 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-37. TEST_SPEED レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-0	ELECTRICAL_PERIOD_LSB	R	0h	このレジスタを読み出すと、モーターの電気的サイクルの周期が取得できます。FG ピンが使用できないテスト モード中の速度フィードバックに役立ちます。ELECTRICAL_PERIOD_MSB ビット フィールド説明の式。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.2.6 USR_OTP_CFG レジスタ (オフセット = 25h) [リセット = 00h]

USR_OTP_CFG を 表 7-38 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-38. USR_OTP_CFG レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7	USR_OTP_CRC_ERR	R	0h	USR_OTP_CRC チェックのステータス 0h = CRC エラーなし 1h = CRC エラーあり
6	DEVICE_OTP_CRC_ERR	R	0h	デバイスの OTP 内容に対して計算された DEVICE OTP CRC のステータス 0h = CRC エラーなし 1h = CRC エラーあり
5	予約済み	R/W	0h	予約済み
4-3	USR_OTP_PAGE_USED	R	0h	最新のロード動作の対象となった OTP を示します。どの OTP が書き込み済みかを判定するには、これらのビットを CRC および CRC エラー フラグの情報と組み合わせて使用する必要があります。 0h = 無効な組み合わせ (電源投入時にデバイスが少なくとも 1 つの OTP の読み出しを試みるため)。 1h = 最新のロード試行は USR_OTP1 からのもの。CRC 値と組み合わせて使用し、USR_OTP1 が書き込み済みかを判定します。 2h = 最新のロードは USR_OTP2 からのもの。 3h = 予期されない無効な組み合わせ。
2	USR_OTP_PAGE_SEL	R/W	0h	このビットは、指定された動作の対象が第 1 OTP ページであるか、第 2 OTP ページであるかを示します。 0h = OTP ページ 1 1h = OTP ページ 2
1	USR_OTP_PROG_VERIFY	R/W	0h	予約済み
0	USR_OTP_PROG_ALL	R/W	0h	USR_OTP_PAGE_SEL に従って USR_OTP ページをプログラムするには、このビットに 1h を書き込みます

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7.2.7 USR_OTP_PRG_UNLOCK レジスタ (オフセット = 26h) [リセット = 00h]

USR_OTP_PRG_UNLOCK を 表 7-39 に示します。

概略表に戻ります。

表 7-39. USR_OTP_PRG_UNLOCK レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	説明
7-3	予約済み	R	0h	予約済み
2-0	USR_OTP_PROG_UNLOCK	R	0h	USR_OTP のプログラミングまたはプログラム検証動作へのアクセスをロック解除するには、このビットに 2h、1h、4h のシーケンスを連続した書き込みフレームで書き込む必要があります

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション セクションにある情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI はその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

MC121 は、単相ブラシレス DC モーターの駆動に使用できます。以下の設計手順は、MC121 とのインターフェイスに使用できます。

8.1.1 外付け部品

このセクションでは、ファン アプリケーションにおける MC121 の推奨外付け部品について説明します。

電源関連部品

図 8-1 に、ファン モジュールの電源端子に配置される一般的な部品を示します。電源と直列に接続された D_1 ダイオードは、誤って電源端子が逆接続された場合に MC121 を保護します。MC121 を適切に機能させるには、電源デカップリング コンデンサが必要であり、最小値として 0.1µF を推奨します。VM ピンの近くにオプションの バルク コンデンサ C_{BULK} を配置すると、モーター動作中の V_{VM} 電源電圧を安定化できます。過渡時のマージンを確保するため、等価直列抵抗 (ESR) が低いセラミック コンデンサで、電源電圧の 2 倍の電圧定格を持つものを推奨します。容量の値はアプリケーションに応じて 1µF ～ 10µF が推奨されます。

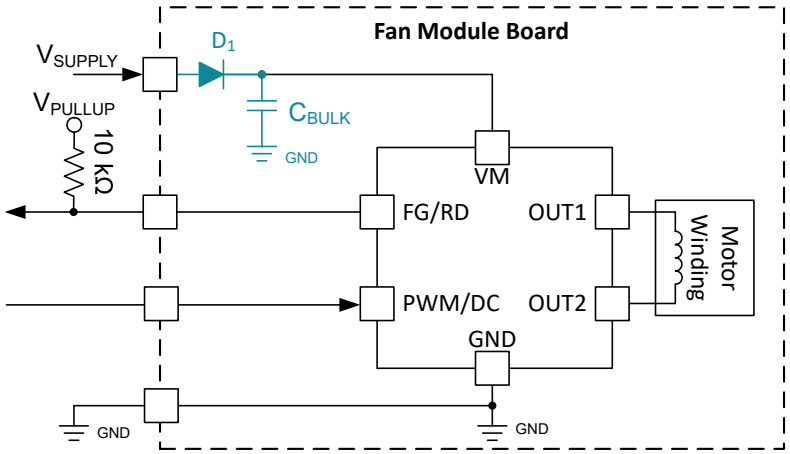


図 8-1. 代表的なファン モジュール外付け部品

モーター電流が大きく、回転子の慣性が高いモーター システムでは、整流動作中にインダクタに蓄積されたエネルギーにより、H ブリッジから VM ノードへ大電流が流れ込むことがあります。C_{BULK} コンデンサの追加電荷によって、V_{VM} 電源電圧が上昇します。MC121 は過電圧保護機能を備えていますが、電源レールに保護クランプ部品を追加することで、電圧スパイクの大きさを抑制できます。これらの部品は、電源レールに対する ESD 保護としても機能します。

図 8-2 に、VM ノードに ツェナー ダイオードまたは TVS ダイオード (D_2) を使用した例を示します。ダイオードのクランプ電圧は、ファン システムの最大動作電圧より高く、「推奨動作条件」の表に示される MC121 の最大動作電圧より低い必要があります。電源ラインに RC スナバを使用することで、電圧スパイクや ESD からドライバを保護できます (図 8-3)。TI では、$C_{SNUBBER}$ に 1µF、$R_{SNUBBER}$ に 2Ω を推奨しています。また、C_{BULK} と並列に 電解コンデンサを使用することもできます。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

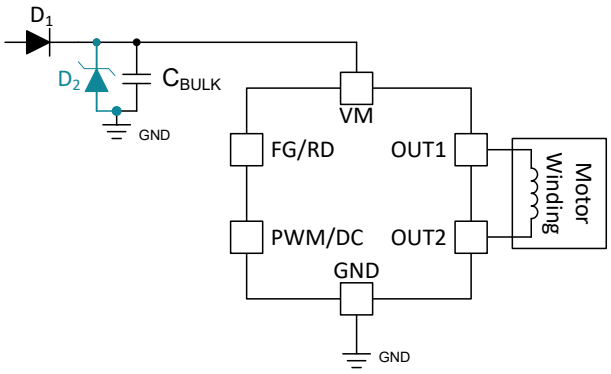


図 8-2. VM のクランプ ダイオード

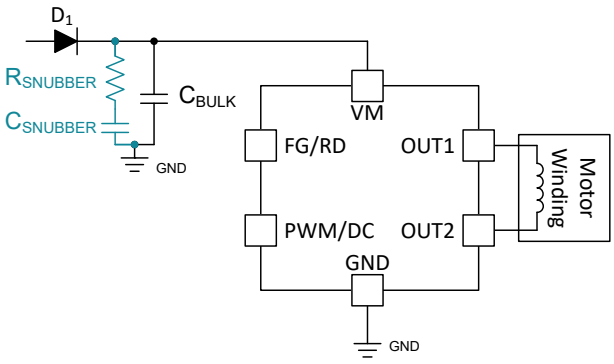


図 8-3. VM のスナバ

PWM および FG/RD ピンの部品

図 8-1 に、ファン モジュールの PWM 制御、速度または故障フィードバックに必要な最小限の外付け部品を示します。FG/RD ピンはオープン ドレイン出力であり、適切な電圧の出力信号を得るには、外付けプルアップ抵抗が必要です。オープン ドレイン出力が Low にアサートされたとき、FG/RD ピンに流れ込む電流が 5mA 未満となるよう、プルアップ抵抗値を選択する必要があります。図 8-4 に示すように、PWM 入力と FG/RD 出力にインラインで抵抗を追加すると、コネクタ ワイヤ上の ESD からドライバを保護するのに役立ちます。図 8-5 に示すように、FG/RD 信号および PWM 信号にクランプ ダイオードまたは TVS ダイオードを追加することで、ESD に対する保護をさらに強化できます。

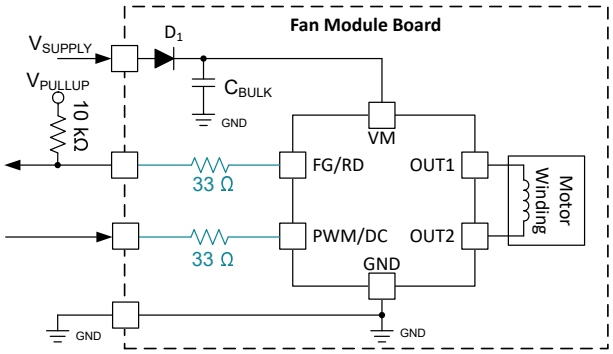


図 8-4. PWM と FG/RD の抵抗

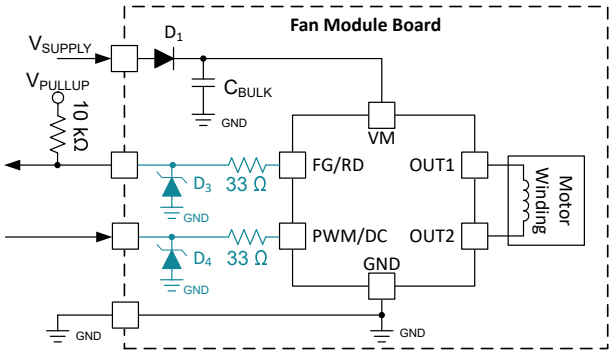


図 8-5. PWM と FG/RD の抵抗およびツェナー ダイオード

一部の単相ファン モジュールでは、FG/RD および PWM ピンにオープン コレクタ インターフェイスが必要です。図 8-6 および 図 8-7 に、オープン コレクタ インターフェイス用にファン モジュールの内側および外側の部品を接続する例を示します。

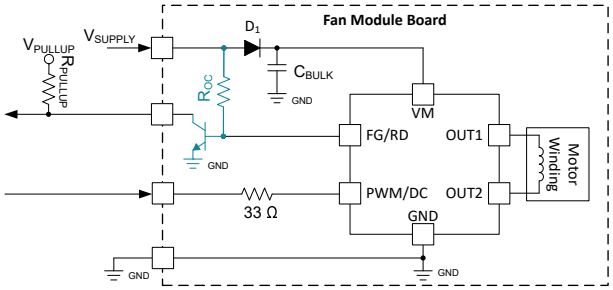


図 8-6. FG/RD のオープン コレクタ

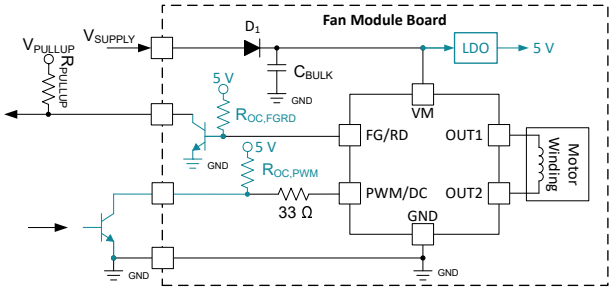


図 8-7. PWM および FG/RD のオープン コレクタ

OTP およびテスト モードのプログラミング

MC121 は、OTP (ワンタイム プログラマブル) モードで、FG/RD および PWM ピンで I²C インターフェイスをサポートします。OTP モードでは、設計者はさまざまなデバイス設定をテストでき、量産時にデバイスの OTP をプログラムできます。図 8-8 に、MC121 のデバイス プログラミング用の外付け部品の接続例を示します。OTP およびテスト モードのプログラミングの詳細については、セクション 6.4.4 を参照してください。

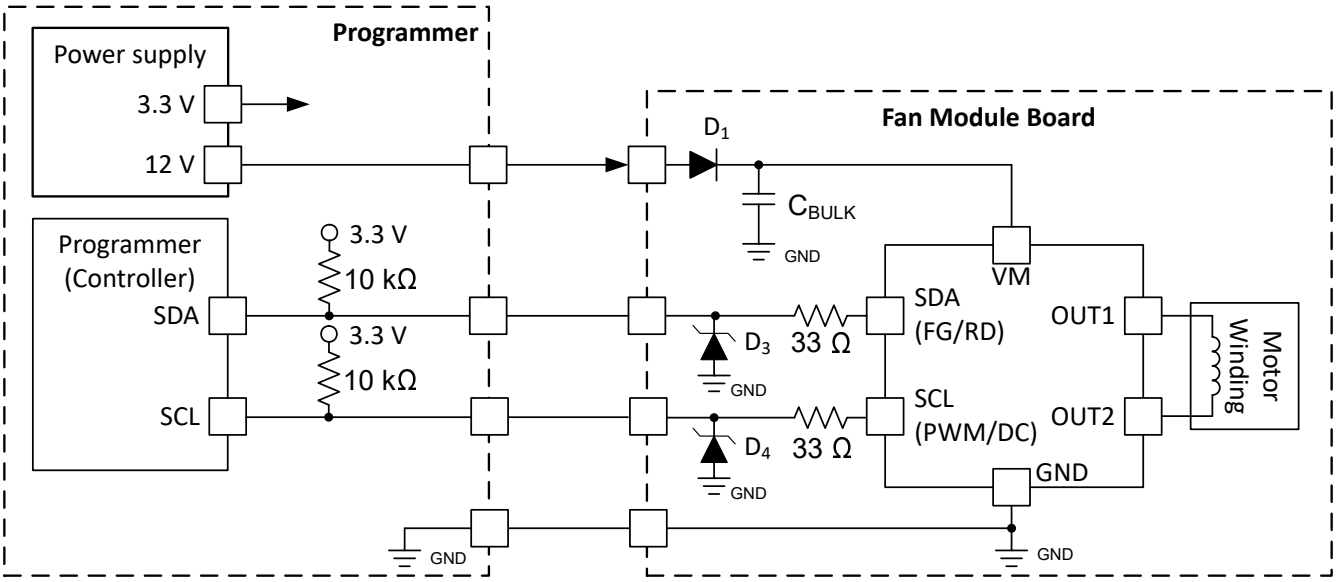


図 8-8. OTP メモリ プログラマおよびファン モジュール

8.2 代表的なアプリケーション

8.2.1 設計要件

電流制限付き単相ブラシレス DC モーター制御

このアプリケーションでは、MC121 を使用して、最大 100% デューティ サイクルで電流制限を備えた単相ブラシレス DC モーターを駆動します。以下の設計手順を使用して、MC121 を電流制限モードで構成できます。

表 8-1 に、システム設計の入力パラメータの例を示します。

表 8-1. 設計パラメータ

パラメータ	値
電源電圧	12V

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

表 8-1. 設計パラメータ (続き)

パラメータ	値
モーターのピーク電流	1.2A
速度入力タイプ	PWM (0% ～ 100% デューティ)、50Hz
FG/RD ピンの機能	回転子ロックの故障時に High をアサート
整流形状	方形波

8.2.2 詳細な設計手順

モーター電圧

ブラシレス DC モーターは通常、特定の定格電圧が指定されています (12V や 24V など)。より高い電圧でモーターを動作させると、同じモーター電力を得るために必要な駆動電流は低くなります。また、動作電圧が高いほど、到達可能な回転数も高くなります。MC121 は、3.2V ～ 35V の電圧範囲での動作が可能です。

デバイス構成設定

MC121 のデフォルト OTP 構成を、表 7-1 に示します。デフォルト値は、モーターの起動および閉ループ動作を確実に行うために選択されています。MC121 のチューニングおよびプログラミングのガイドを参照してください。このガイドでは、単相 BLDC モーターを開ループおよび閉ループ構成で調整する手順を段階的に説明し、デバイス機能を紹介しています。

表 8-2. 推奨 OTP 構成値 (デフォルトからの変更)

レジスタ値名	推奨値
PWM_IN_RANGE	1h
FGRD_INVERT	1h
FGRD_MODE	1h
PWM_MODE	7h
SILENCE_ANGLE	4h
ILIMIT_SEL	9h

デバイスの OTP が目的の構成でプログラムされると、デバイスはスタンドアロンで動作可能となり、I^2C シリアル インターフェイスは不要になります。速度は PWM/DC ピンで指示でき、回転子ロックの故障は FG/RD ピンで監視できます。

消費電力と接合部温度の関係

電力損失から MC121 の接合部温度を計算するには、式 1 を使用します。熱抵抗 θ_{JA} は、周囲温度、PCB 層数、上層および下層の銅厚、PCB 面積などの PCB 構成によって異なることに注意してください。

$$T_J[℃] = P_{loss}[W] \times \theta_{JA}\left[\frac{℃}{W}\right] + T_A[℃] \quad (1)$$

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

8.2.3 アプリケーション曲線

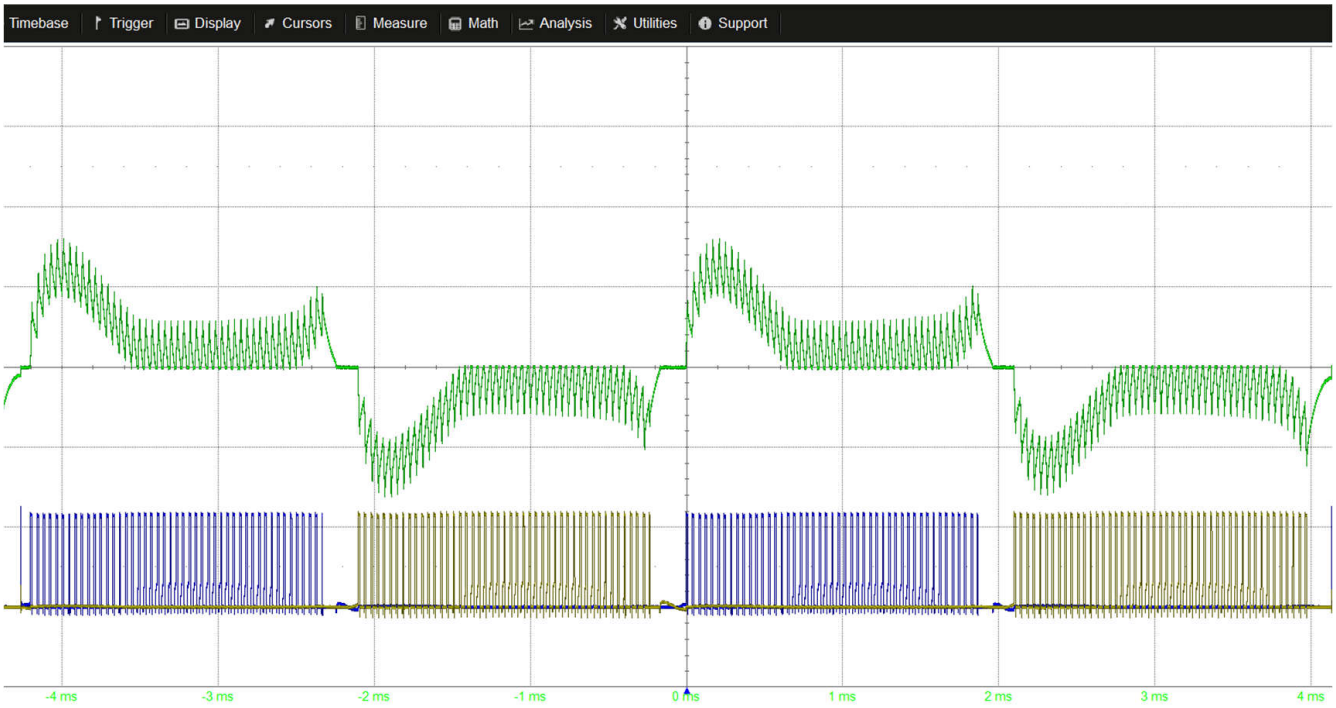


図 8-9. PWM 入力 = 25% での OUTx 電圧および位相電流

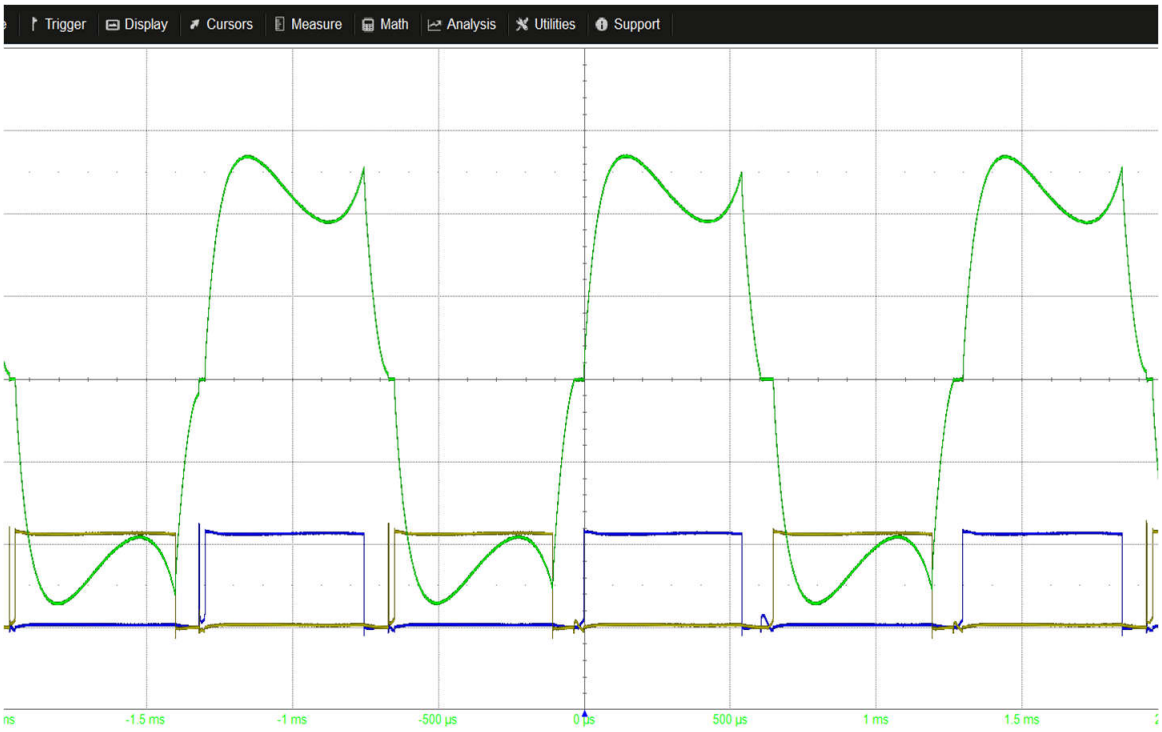


図 8-10. PWM 入力 = 100% での OUTx 電圧および位相電流

8.3 電源に関する推奨事項

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

8.3.1 バルク コンデンサ

適切なローカル バルク容量の確保は、モーター駆動システムの設計において重要な要素です。一般的に、バルク容量が大きいことは有益ですが、コストと物理的なサイズが大きくなるというデメリットもあります。

必要なローカル容量は、次のようなさまざまな要因で決まります。

- モーター システムが必要とする最大電流
- 電源の容量と電流能力
- 電源とモーター システムの間の寄生インダクタンスの大きさ
- 許容される電圧リップル
- モーターの停止またはブレーキ方法

電源とモーター駆動システムの間のインダクタンスにより、電源からの電流の変化する速度が制限されます。ローカル バルク容量が小さすぎると、モーターに大電流を供給しようとする場合、または負荷ダンプが発生した場合、システムの電圧が変動します。十分なバルク容量を備えることで、モーターの電圧は安定し、大電流を素早く供給できます。

一般に、データシートには推奨値が記載されていますが、バルク コンデンサの容量が適切かどうかを判断するにはシステム レベルのテストが必要です。

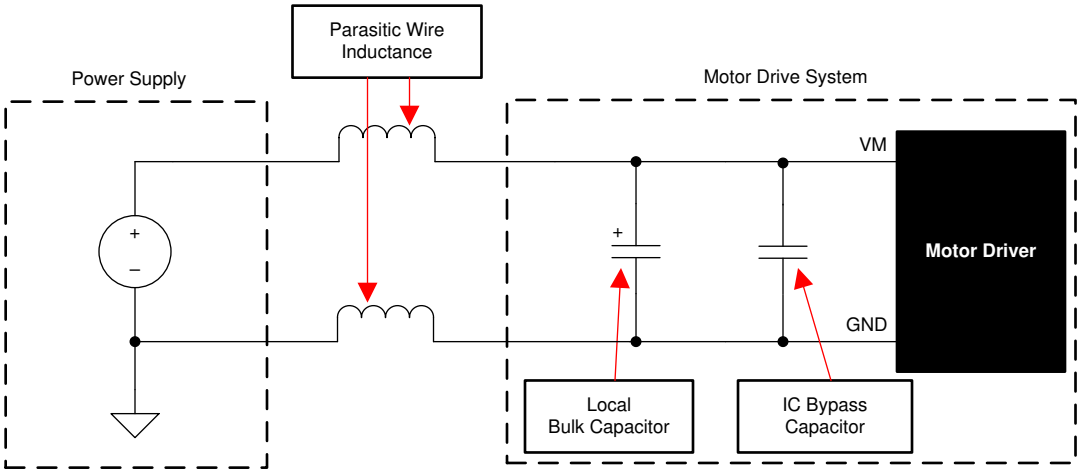


図 8-11. 外部電源を使用したモーター駆動システムの構成例

モーターが電源にエネルギーを伝達する場合のマージンを確保するため、バルク コンデンサの定格電圧は動作電圧より高くすることができます。

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

バルク コンデンサは、モーター ドライバ デバイスを通る大電流パスの距離ができるだけ短くなるように配置することができます。接続用の金属パターンはできる限り幅を広くし、PCB 層を接続する際には多数のビアを使用します。これらの手法により、寄生インダクタンスを最小限にして、バルク コンデンサが大電流を供給できるようになります。

デバイスのバイパス コンデンサはセラミックであり、デバイス ピンに近づけて配置されています。

大電流デバイス出力は、幅の広い金属パターンです。

大きい過渡電流から小電流信号パスへのノイズ結合および EMI を低減するために、PGND と AGND のグランドは分割します。寄生効果を低減し、デバイスの消費電力を改善するために、電力段以外のすべての回路 (サーマル パッドを含む) を AGND に接続することを推奨します。

本デバイスのサーマル パッドは、PCB の最上層のグランド プレーンに半田付けします。複数のビアを使用して最下層の大きなグランド プレーンに接続します。大きい金属プレーンおよび複数のビアを使うと、本デバイス内で発生する $I^2 \times R_{DS(on)}$ の熱を放散するのに役立ちます。

放熱性を高めるため、サーマル パッド グランドに接続されたグランド領域を、PCB の全層にわたって最大化します。厚い銅のベタ パターンを使うと、接合部から外気への熱抵抗が下がり、ダイ表面からの放熱性が改善されます。

図 8-12 に、MC121 の DEZ パッケージのレイアウト例を示します。適切なモーターの整流には、MC121 を 2 つの固定子極の間に配置し、ホール素子が回転子磁石の直下に位置するようにする必要があります。DYM パッケージの配置例を、図 8-13 に示します

8.4.2 レイアウト例

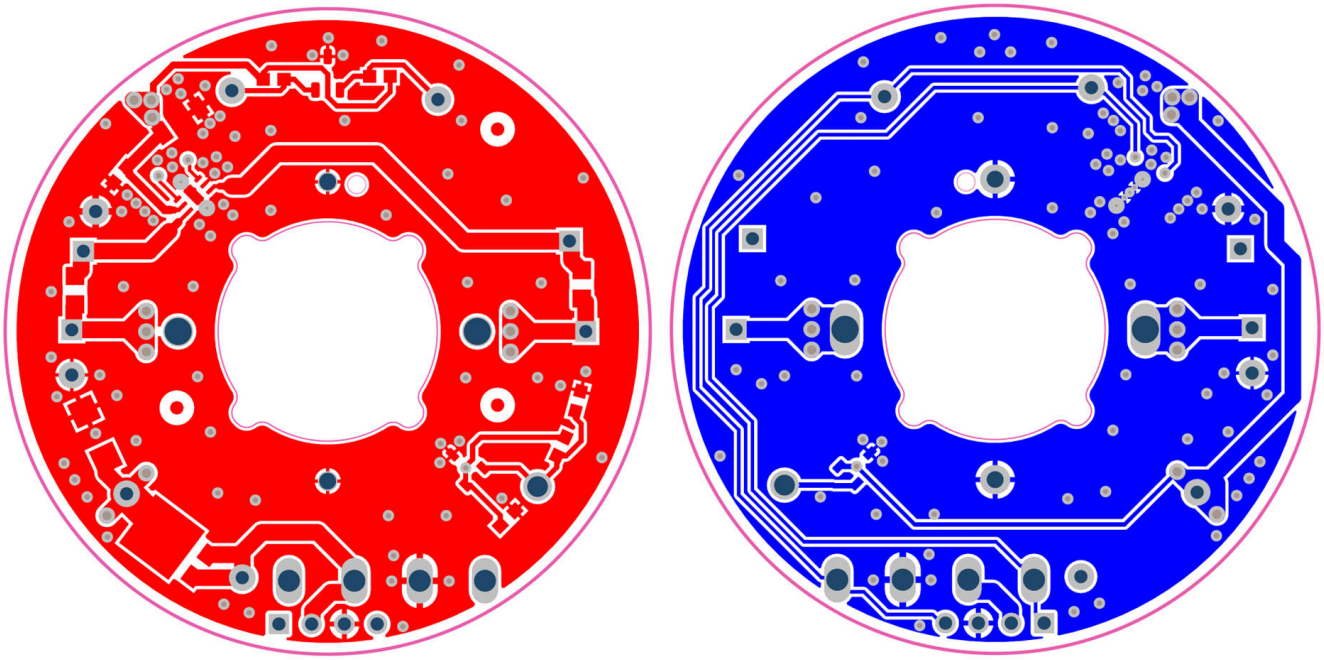


図 8-12. DEZ パッケージの推奨レイアウト例

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

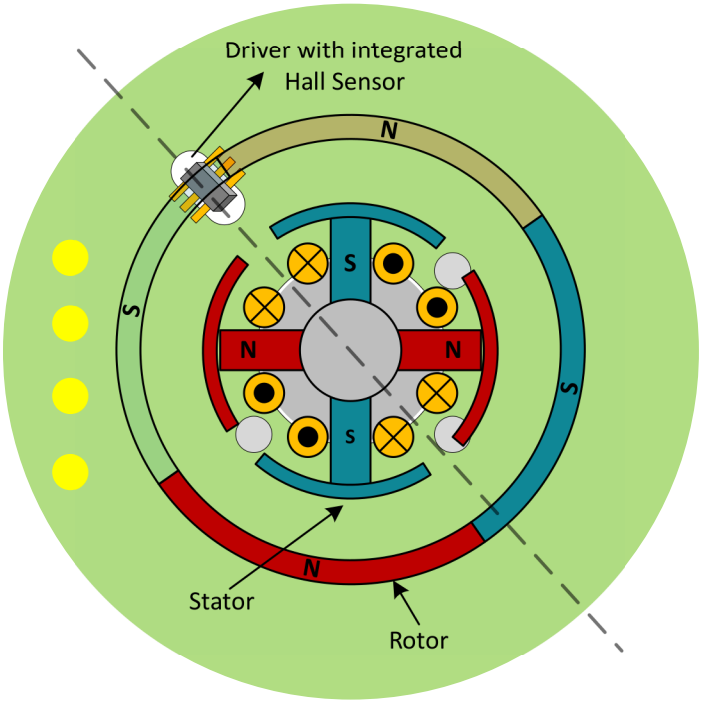


図 8-13. DYM パッケージの推奨配置例

8.5 ホール素子の位置

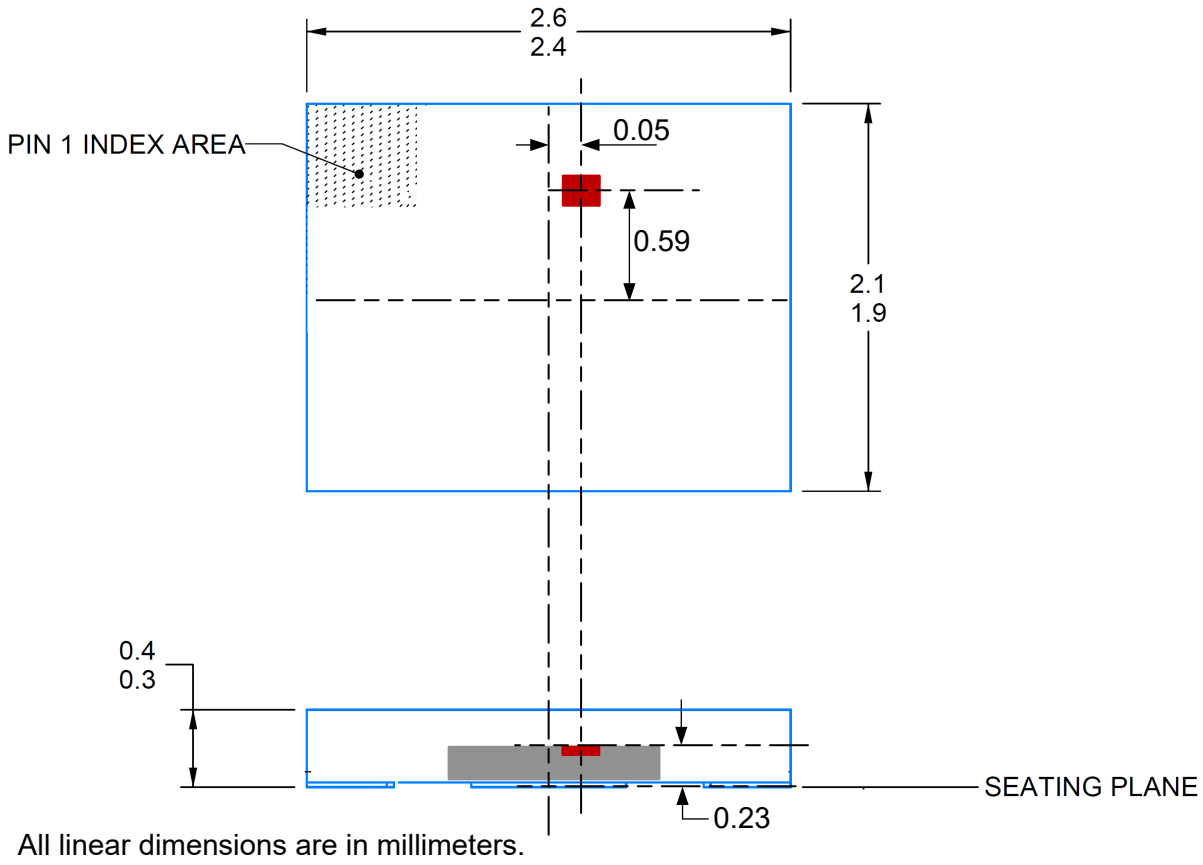
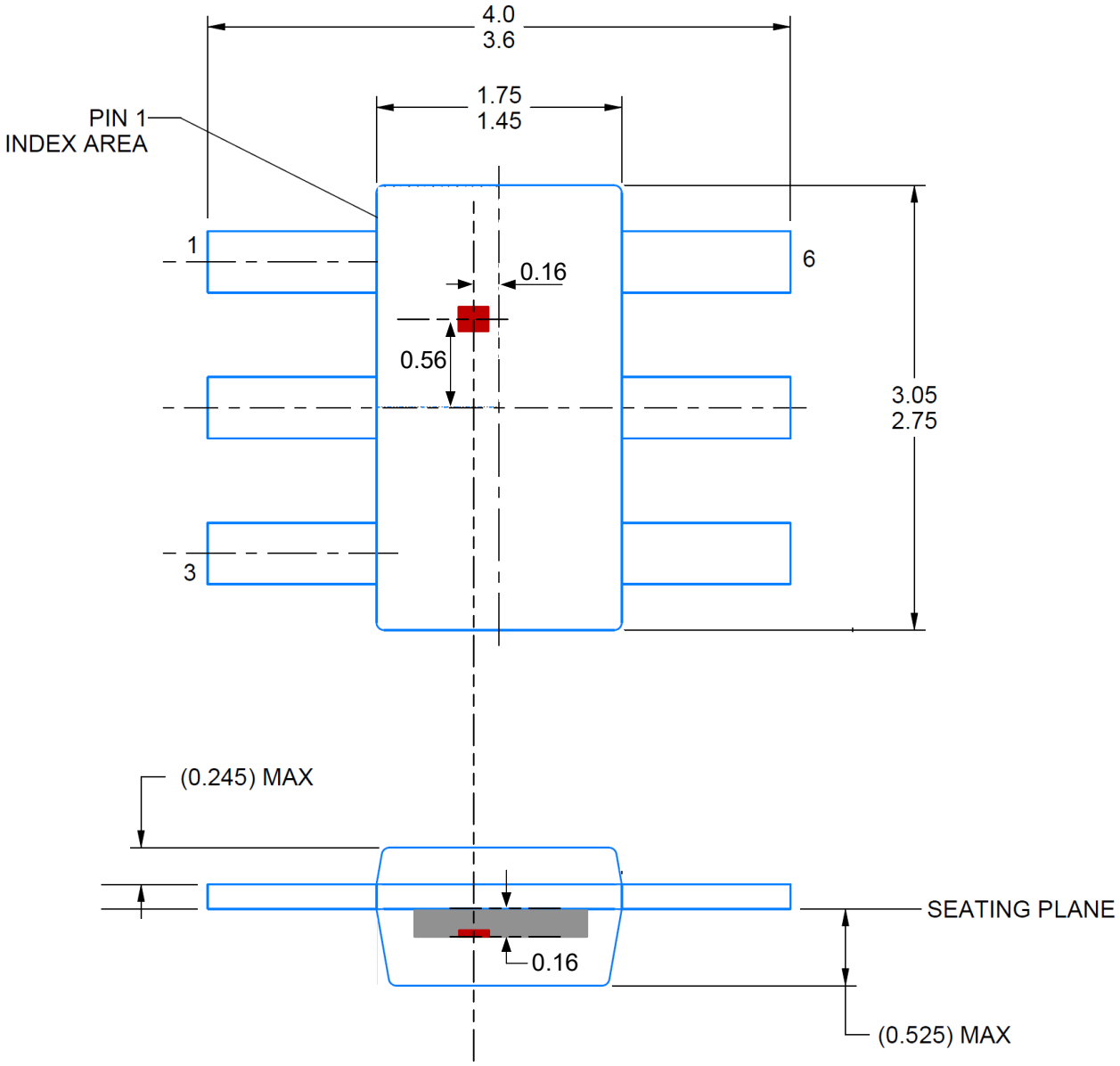


図 8-14. DEZ パッケージのホール素子の位置

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated



All linear dimensions are in millimeters.

図 8-15. DYM パッケージのホール素子の位置

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツでは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、システムの開発を行うためのツールやソフトウェアを、以下に挙げます。

9.1 デバイス サポート

9.2 ドキュメントのサポート

9.2.1 関連資料

9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。 変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.4 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

9.5 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.6 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.7 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集　　この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision * (December 2025) to Revision A (March 2025)	Page
• デバイスのステータスを「事前情報」から「量産データ」に更新。	1

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
MC121DEZR	Active	Production	X2SON (DEZ) | 6	5000 | LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	121

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF MC121 :

- Automotive : MC121-Q1

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

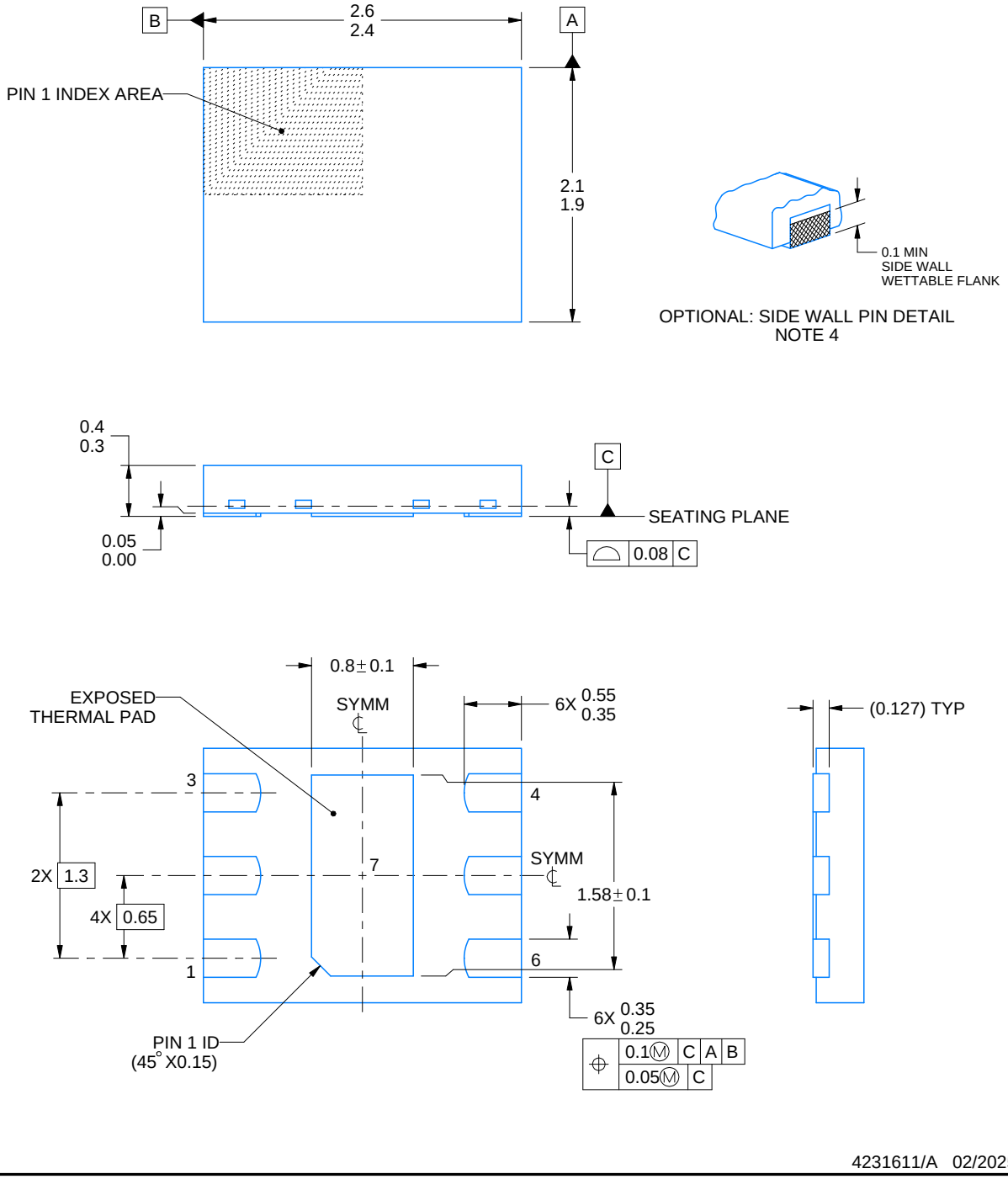
DEZ0006A



PACKAGE OUTLINE

X2SON - 0.4 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



NOTES:

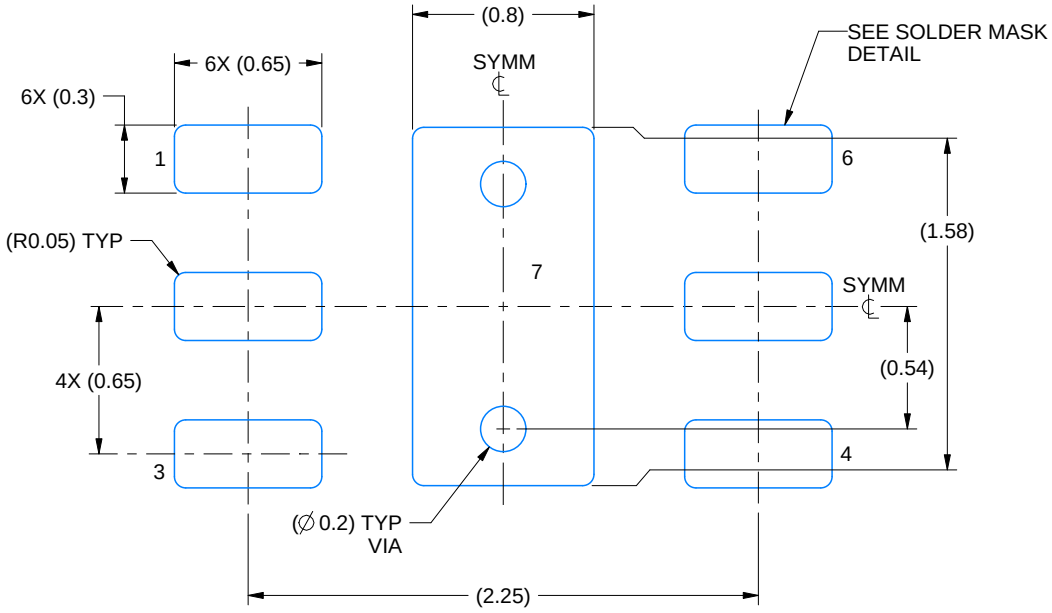
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.
4. Minimum 0.1 mm solder wetting on pin side wall. Available for wettable flank version only.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

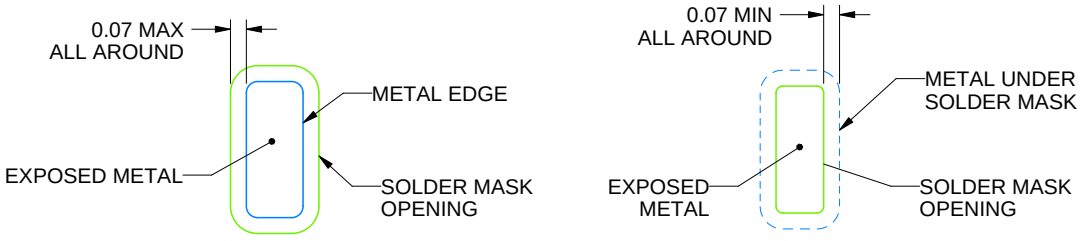
DEZ0006A

X2SON - 0.4 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 30X



SOLDER MASK DETAILS

4231611/A 02/2025

NOTES: (continued)

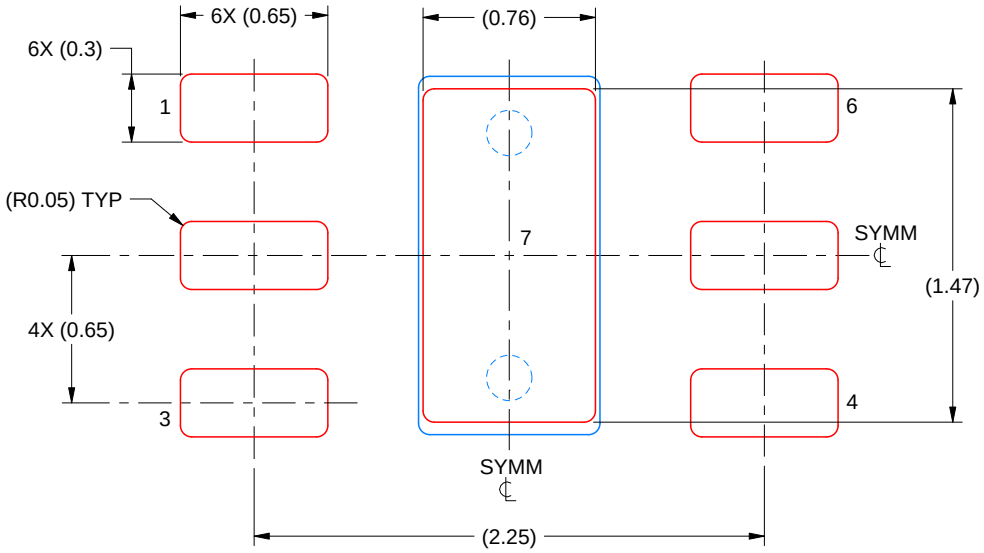
5. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
6. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DEZ0006A

X2SON - 0.4 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
SCALE: 30X

EXPOSED PAD 7
88% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE

4231611/A 02/2025

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、 TI の販売条件 、 TI の総合的な品質ガイドライン 、 ti.com または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。 TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月